

EVM User's Guide: TMD62LEVM

AM62L 評価基板



説明

TMD62LEVM 評価基板 (EVM) は、低コストかつ性能が最適化された AM62L アプリケーション プロセッサ ファミリー用に設計されています。AM62L は、スケーラブルな Arm® Cortex®-A53 コアの性能と、以下のような組み込み機能を搭載しています。すなわち、マルチメディア DSI サポート、チップ内蔵 ADC、高度な低消費電力管理モード、および IP 保護とセキュア ブート用の広範なセキュリティ オプションです。AM62L デバイス ファミリーは、Linux® と FreeRTOS™ を用いた開発をサポートしています。

TMD62LEVM には、広範な産業用アプリケーションに適した幅広いペリフェラル セットが含まれており、また、インテリジェントな機能や最適化された電源アーキテクチャも提供します。さらに、AM62L に搭載されている幅広いペリフェラル セットにより、以下のようなシステム レベルの接続性を実現できます。すなわち、USB、MMC/SD、OSPI、CAN-FD、ADC、およびプロトタイプ製の製作を容易にするその他のインターフェイスです。また、SoC と LPDDR4 それぞれの温度条件を監視するために 2 つのオンボード温度センサを採用しています。

設計を開始

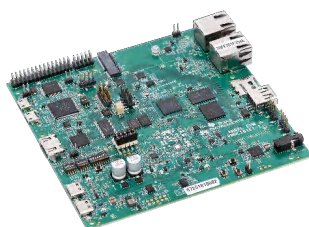
1. [TMD62LEVM](#) で EVM を注文します。
2. 評価基板の [設計ファイル](#) をダウンロードします。
3. [TMD62LEVM](#) からソフトウェアをダウンロードします。
4. 『EVM ユーザー ガイド』を読みます。

特長

- ギガビット イーサネット RJ45 拡張コネクタ x 2
- 2GB LPDDR4 メモリ
- 512MB OSPI フラッシュ メモリ
- 1GB QSPI フラッシュ メモリ
- 32GB eMMC フラッシュ メモリ
- microSD カード スロット
- USB 2.0 Type-C® x 1
- USB Type-A 2.0 x 1
- MCAN ヘッダ x 3
- 3.5mm TRRS オーディオ ジャック x 1
- Wi-Fi/BT モジュール用 M.2 コネクタ
- 外部ディスプレイ用 HDMI®コネクタ
- GPIO 拡張コネクタ x 2
- ADC ヘッダー
- DSI ディスプレイ コネクタ

アプリケーション

- [ビル オートメーション](#): スマート ハウス デバイス、HVAC コントローラ、IoT デバイス
- [エネルギー インフラ](#): EV 充電および給電機器、スマート メーター
- [産業用オートメーション](#): ファクトリ オートメーション、ロボット、産業用 HMI
- [医療](#): 医療用機器、患者モニタリング システム



TMD62LEVM のハードウェア ボード



このリファレンスデザインは HDMI®技術を採用しています。

目次

説明.....	1
設計を開始.....	1
特長.....	1
アプリケーション.....	1
1 評価基板の概要.....	4
1.1 はじめに.....	4
1.2 キットの内容.....	4
1.3 仕様.....	5
1.4 製品情報.....	5
1.5 EVM のリビジョンおよびアセンブリ バリエーション.....	6
2 ハードウェア.....	6
2.1 補足画像.....	6
2.2 主な特長.....	7
2.3 電源要件.....	8
2.4 設定および構成.....	9
2.5 電源オン / オフの手順.....	16
2.6 インターフェイス.....	19
2.7 電源.....	42
2.8 クロック処理.....	48
2.9 リセット.....	49
2.10 拡張ヘッダ.....	50
2.11 割り込み.....	52
2.12 I2C アドレス マッピング.....	52
3 ハードウェア設計ファイル.....	54
3.1 回路図.....	54
3.2 PCB のレイアウト.....	54
3.3 部品表 (BOM).....	54
4 準拠に関する情報.....	54
4.1 準拠および認証.....	54
5 追加情報.....	54
5.1 ハードウェアまたはソフトウェアに関する既知の問題.....	54
5.2 商標.....	55
6 関連資料.....	55
7 改訂履歴.....	55

図の一覧

図 1-1. AM62L EVM の機能ブロック図.....	5
図 2-1. AM62L EVM の上面.....	6
図 2-2. AM62L EVM の底面.....	7
図 2-3. ブートモード スイッチの例 (フル ピン数構成 - SD カード ブート).....	9
図 2-4. MMCSD/UART バックアップ用のブートモード スイッチの構成.....	15
図 2-5. xSPI/UART バックアップ用のブートモード スイッチの構成.....	15
図 2-6. NOBOOT (DEVBOOT = 0) / バックアップなし用のブートモード スイッチの構成.....	15
図 2-7. GPMC NAND/USB バックアップ用のブートモード スイッチの構成.....	15
図 2-8. GPMC NAND/UART バックアップ用のブートモード スイッチの構成.....	16
図 2-9. eMMC/MMCSD バックアップ用のブートモード スイッチの構成.....	16
図 2-10. フル ピン数構成のブートモード (SD カード ブート) の例.....	17
図 2-11. RTC 電源選択ヘッダ.....	17
図 2-12. DSI インターフェイスのブロック図.....	20
図 2-13. オーディオ コーデック インターフェイスのブロック図.....	22
図 2-14. HDMI インターフェイスのブロック図.....	23
図 2-15. JTAG インターフェイスのブロック図.....	24
図 2-16. テスト オートメーション インターフェイスのブロック図.....	25
図 2-17. UART インターフェイスのブロック図.....	27
図 2-18. USB 2.0 Type-A インターフェイスのブロック図.....	28
図 2-19. USB 2.0 Type-C インターフェイスのブロック図.....	29

図 2-20. MCAN インターフェイスのブロック図.....	30
図 2-21. ADC インターフェイスのブロック図.....	31
図 2-22. LPDDR4 インターフェイスの ブロック図.....	32
図 2-23. OSPI のブロック図.....	33
図 2-24. eMMC インターフェイスのブロック図.....	35
図 2-25. microSD インターフェイスのブロック図.....	36
図 2-26. M.2 インターフェイスの ブロック図.....	37
図 2-27. 基板 ID EEPROM インターフェイスのブロック図.....	38
図 2-28. イーサネット インターフェイスのブロック図.....	39
図 2-29. 電源入力ブロック図.....	43
図 2-30. 電力アーキテクチャ.....	44
図 2-31. 5V および 3.3V 電源の生成を可能にするロジック.....	45
図 2-32. 電源シーケンス.....	46
図 2-33. クロック アーキテクチャ.....	48
図 2-34. SOC RTC ドメイン クロック.....	49
図 2-35. リセットの ブロック図.....	50
図 2-36. I2C インターフェイス ツリー.....	53

表の一覧

表 1-1. EVM の PCB 設計リビジョンおよびアセンブリ バリエーション.....	6
表 2-1. Type-C ポートの電源ロール.....	8
表 2-2. 推奨外部電源.....	9
表 2-3. フル構成と削減構成のブートモード ピンのマッピング.....	10
表 2-4. ブートモード ピンのマッピング (ピン数削減構成).....	10
表 2-5. ブートモード ピンのマッピング (フルピン数構成).....	11
表 2-6. PLL リファレンス クロックの選択 BOOTMODE[2:0].....	11
表 2-7. ブート デバイス選択 BOOTMODE[6:3].....	11
表 2-8. プライマリ ブート メディアの構成 BOOTMODE[9:7].....	12
表 2-9. バックアップ ブート モードの選択 BOOTMODE[13:10].....	12
表 2-10. シリアル NAND 構成フィールド.....	12
表 2-11. OSPI ブート構成フィールド.....	13
表 2-12. QSPI ブート構成フィールド.....	13
表 2-13. SPI ブート構成フィールド.....	13
表 2-14. SD カード ブート構成フィールド.....	13
表 2-15. eMMC ブート構成フィールド.....	13
表 2-16. USB ブート構成フィールド.....	13
表 2-17. xSPI ブート構成フィールド.....	14
表 2-18. ユーザー テスト LED.....	16
表 2-19. 15 ピン RTC 電源選択ヘッダ (J14).....	18
表 2-20. 電力テスト ポイント.....	18
表 2-21. インターフェイス マッピング.....	19
表 2-22. DSI ディスプレイ コネクタのピン配置 (J23).....	20
表 2-23. JTAG コネクタ (J10) のピン配置.....	24
表 2-24. UART ポート インターフェイス.....	26
表 2-25. CPSW イーサネット PHY1 のデフォルト構成.....	40
表 2-26. CPSW イーサネット PHY2 のデフォルト構成.....	40
表 2-27. I/O エクスパンダの信号詳細.....	40
表 2-28. AM62L ローパワー SK EVM ペリフェラルを搭載した AM62D ローパワー SoC のマッピング.....	41
表 2-29. SoC 電源.....	46
表 2-30. INA I2C デバイス アドレス.....	47
表 2-31. クロック表.....	49
表 2-32. 10 ピン GPIO 拡張コネクタ (J3).....	51
表 2-33. 30 ピン GPIO 拡張コネクタ (J2).....	51
表 2-34. EVM のプッシュ ボタン.....	52
表 2-35. I2C マッピング表.....	54

1 評価基板の概要

1.1 はじめに

本テクニカル ユーザー ガイドでは、テキサス インストルメンツ (TI™) の AM62L システム オン チップ (SoC) を実装した低コストの評価基板である、AM62L EVM のハードウェア アーキテクチャについて説明します。AM62L プロセッサは、組み込み Linux および RTOS オペレーティング システムを実行できるデュアルコア 64 ビット Arm Cortex A53 マイクロプロセッサで構成されています。AM62L は、スケーラブルな性能、高度なセキュリティ、電力効率の優れたコンピューティング能力を低コストで実現します。その結果、開発期間の短縮や、汎用性が高く低消費電力でコスト重視の汎用ソリューションへの導入を進めることができます。

AM62L EVM を使用すると、HDMI (DPI 経由) や MIPI DSI を使用した高解像度ディスプレイ機能と、シリアル、イーサネット、USB、その他のインターフェイスを使用した産業用通信ソリューションを実現できます。AM62L EVM は他のプロセッサまたはシステムと通信でき、通信ゲートウェイとして動作することも可能です。さらに、AM62L EVM は標準リモート I/O システムとして直接動作すること、または産業用通信ネットワークに接続したシンプルなセンサとして動作できます。テキサス インストルメンツ (TI™) の Code Composer Studio™ IDE などの標準的な開発ツールを使用し、組み込み済みエミュレーション ロジックを通じてエミュレーションやデバッグを実施できます。

1.2 キットの内容

パッケージには以下が含まれます。

- 「TMDS62LEVM」EVM (評価基板)
- 『EVM ユーザー ガイド』冊子
- EVM の免責事項と標準約款

1.3 仕様

図 1-1 に、AM62L EVM の機能ブロック図を示します。

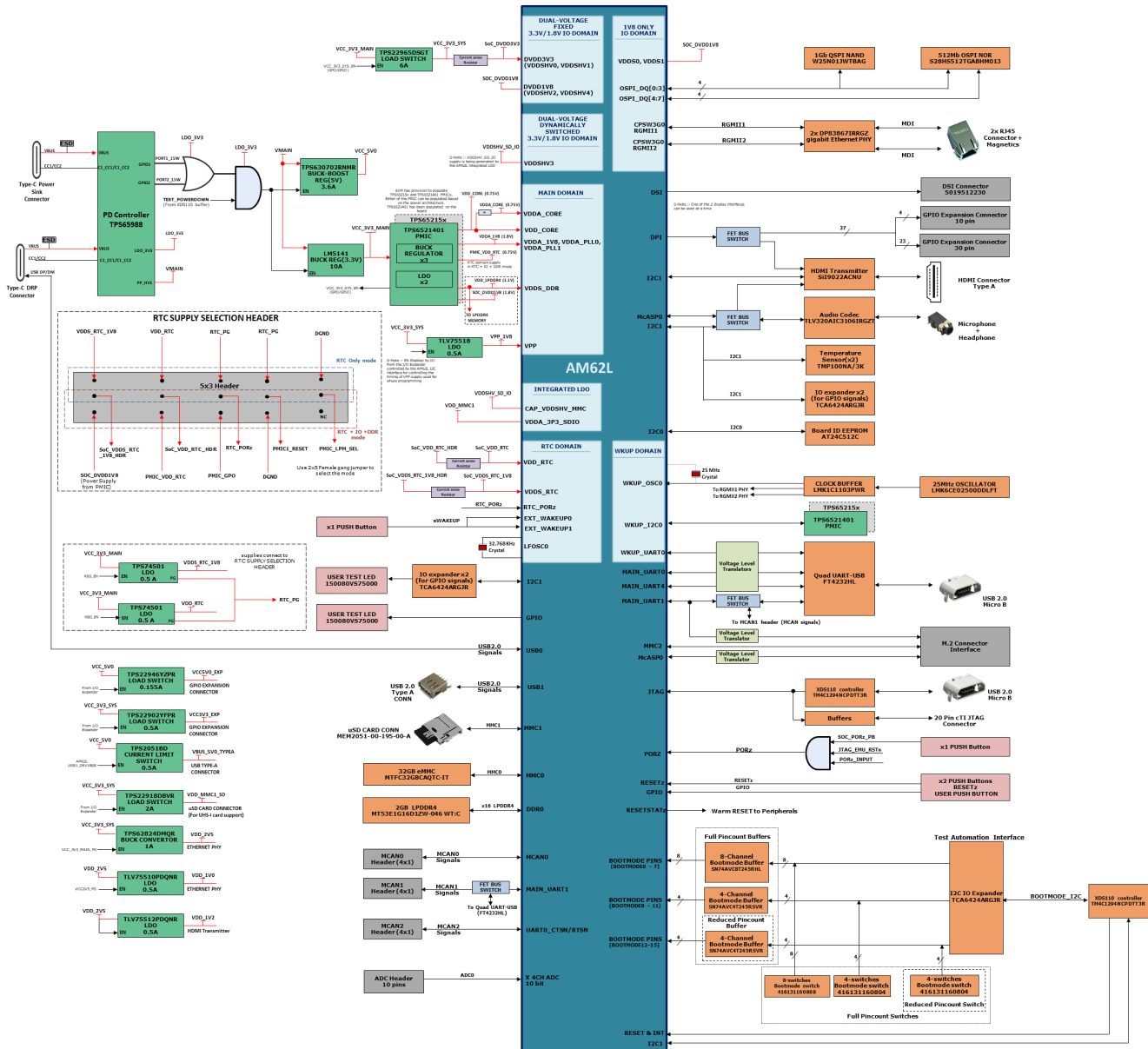


図 1-1. AM62L EVM の機能ブロック図

1.4 製品情報

AM62L EVM は、機能の豊富な SDK (ソフトウェア開発キット) を使用する Linux および FreeRTOS の開発をサポートしています。オンチップ エミュレーション ロジックを搭載しているため、TI™ の Code Composer Studio™ IDE などの標準的な開発ツールを使用したエミュレーションやデバッグが可能です。また、すぐに使用できる直観的なユーザー ガイドにより迅速に設計評価を開始できます。

1.5 EVM のリビジョンおよびアセンブリ バリエーション

AM62L EVM のさまざまな PCB 設計リビジョンとアセンブリ バリエーションを、表 1-1 に示します。特定の PCB リビジョンは PCB 上にシルクスクリーンで示され、特定のアセンブリ バリエーションは追加のステッカー ラベルで示されています。

表 1-1. EVM の PCB 設計リビジョンおよびアセンブリ バリエーション

OPN	PCB リビジョン	アセンブリ バリエーション	リビジョンとアセンブリ バリエーションの説明
TMDS62LEVM	PROC181E1	該当なし (単一バリエーションのみ)	AM62L EVM の最初のプロトタイプ、初期リリース リビジョン。TPS65215x (PMIC-1) に実装済み。
TMDS62LEVM	PROC181E1-1	該当なし	AM62L EVM の 2 番目のプロトタイプ、初期リリース リビジョン。多数の変更とバグ修正が実施されています。TPS65214x (PMIC-2) に実装済み。
TMDS62LEVM	PROC181E1-1a	該当なし	SoC の型番を更新した量産バージョン (AM62L32BOGHAANB)。PROC181E1-1 と機能的に同等で、SoC リビジョンのみの変更。PCB 設計の変更はありません

2 ハードウェア

2.1 補足画像

図 2-1 および図 2-2 に、AM62L EVM の上面と底面の画像、および基板上のさまざまなブロックの位置を示します。

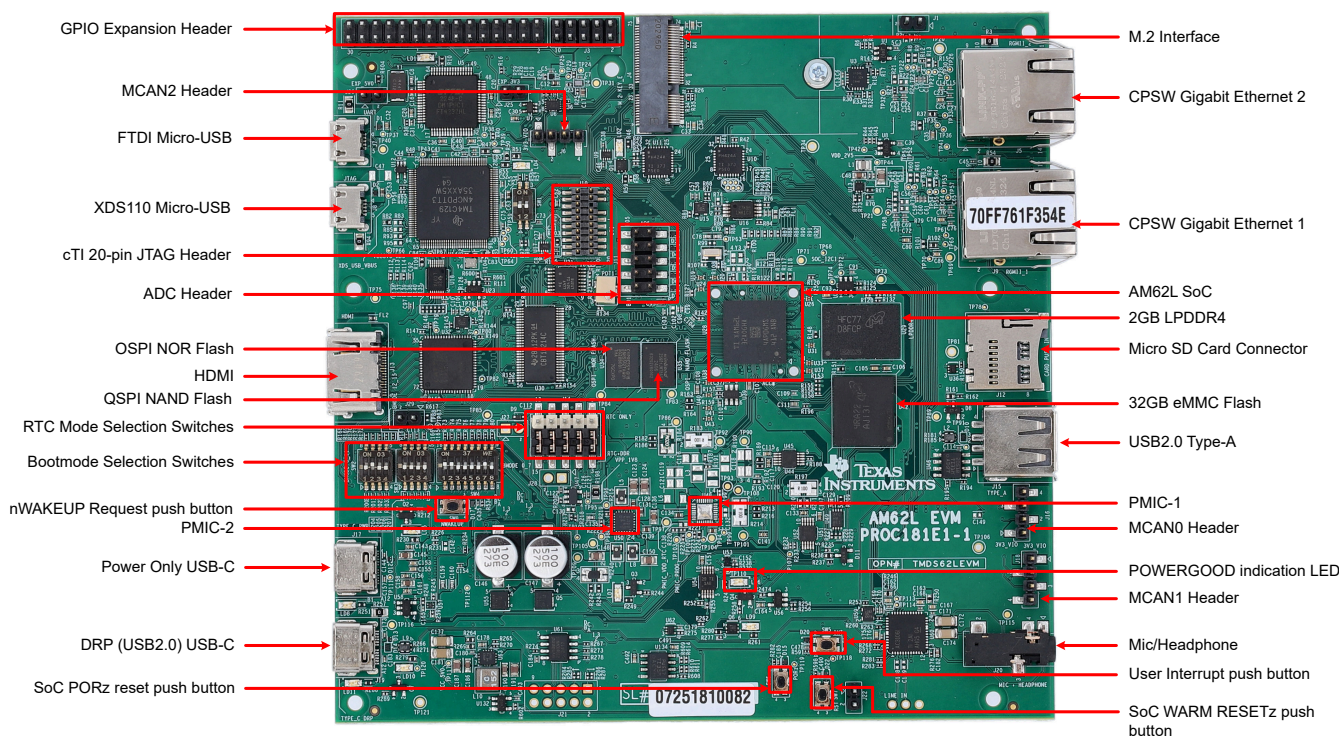


図 2-1. AM62L EVM の上面

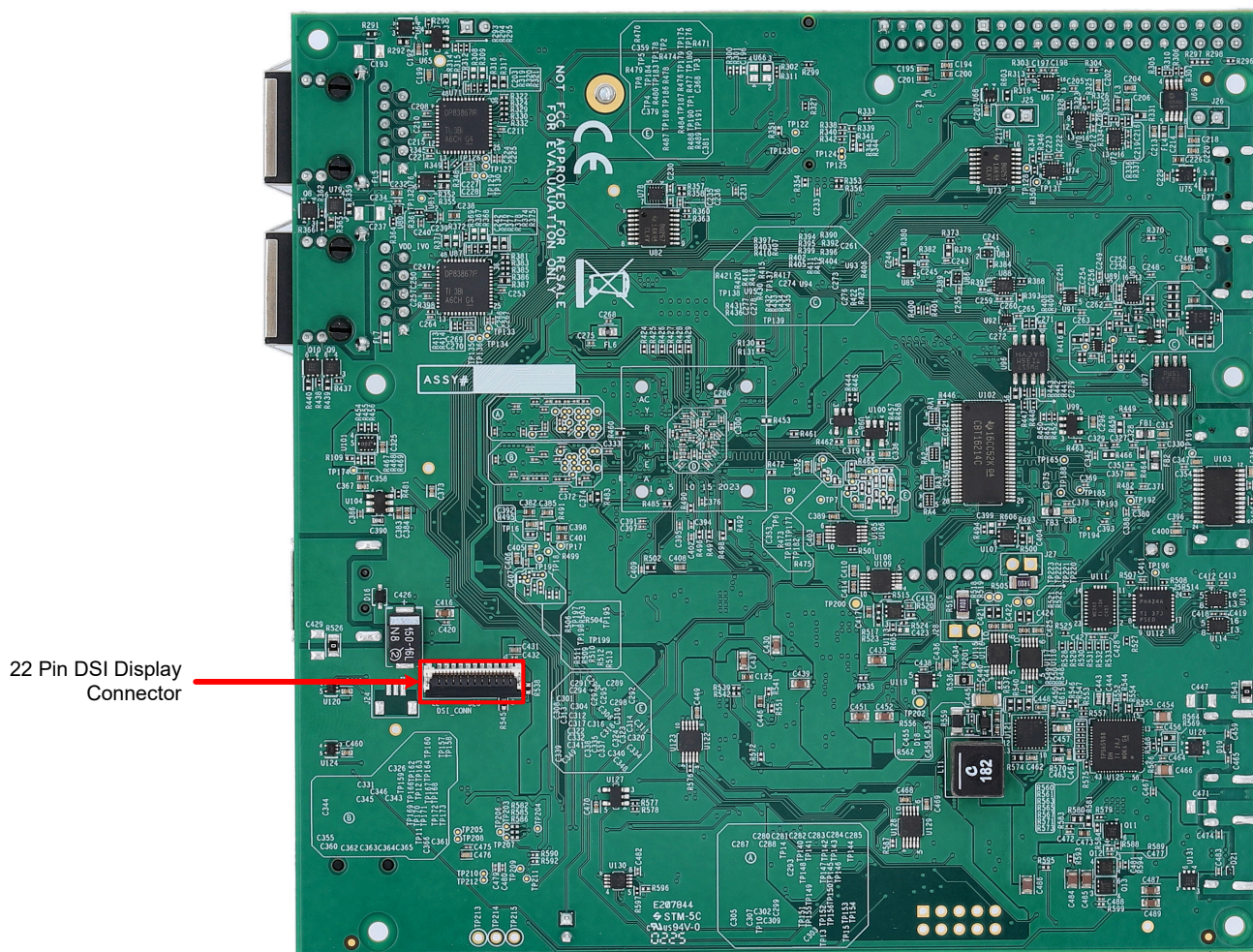


図 2-2. AM62L EVM の底面

2.2 主な特長

AM62L EVM は、高性能のスタンドアロン開発プラットフォームです。これを用いることによって、テキサス インストルメンツの AM62L システム オン チップ (SoC) 用の産業用アプリケーションの評価と開発を行うことができます。

以下のセクションでは、AM62L EVM の主な特長について説明します。

2.2.1 プロセッサ

- AM62L SoC、11.9mm x 11.9mm、373 ピン BGA。

2.2.2 電源

- USB Type-C ポート (入力範囲 5V ~ 12V) x 2
- PMIC、ディスクリートレギュレータ、LDO を使用してプロセッサおよびペリフェラル用に最適化された電源ソリューション
- RTC 専用モードと RTC+xDDR モードのいずれかを選択できる、RTC 電源選択ヘッダ (5x3 ヘッダ) およびジャンパ (5x2)

2.2.3 メモリ

- 最大 1600Mbps のデータレートをサポートする 2GB (16Gb) LPDDR4 x 1
- UHS-1 対応の microSD® カード スロット

- 512Mbit オクタル SPI NOR フラッシュ メモリ x 1
- 1Gbit クワッド SPI NAND フラッシュ メモリ x 1
- 512Kbit I2C (Inter-Integrated Circuit) 基板 ID EEPROM
- HS200 モードをサポートする 32GB eMMC フラッシュ

2.2.4 JTAG / エミュレータ

- XDS110 オンボード エミュレータ
- 外付けエミュレータからの 20 ピン JTAG 接続に対応

2.2.5 サポートされるインターフェイスおよびペリフェラル

- USB 2.0 Type-C インターフェイス x 1、DFP および UFP モード (データ) および DRP モード (電源) をサポート
- USB 2.0 ホスト インターフェイス x 1、Type-A
- 1x HDMI インターフェイス
- オーディオ ライン入力および MIC + ヘッドフォン出力
- M.2 Key E インターフェイスは、Wi-Fi と Bluetooth の両方のモジュールをサポート
- RJ45 コネクタで 10/100/1000Mbps のデータをサポートするギガビット イーサネット ポート x 2
- micro-B USB コネクタ経由のクワッド ポート UART-to-USB 回路
- ユーザー テスト LED
- SoC 電源監視用の INA デバイス x 8
- SoC と LPDDR4 付近に温度監視用温度センサ x 2

2.2.6 アプリケーション固有のアドオン基板をサポートするための拡張コネクタ / ヘッダー

- DSI ディスプレイ コネクタ x 1
- GPIO 拡張コネクタ x 2
- MCAN ヘッダ x 3
- ADC ヘッダ x 1

2.3 電源要件

AM62L EVM は、2 つの USB Type-C コネクタのいずれかを通じて電力を供給できます。

- コネクタ 1 (J17) - 電源ロール – SINK、データ ロールなし
- コネクタ 2 (J19) - 電源ロール – DRP、データ ロール – USB 2.0 DFP または UFP

AM62L EVM は、5V~15V の電圧入力範囲と、3A の電流に対応しています。USB PD コントローラ (メーカー型番 TPS65988DHRSHR) は、ケーブル検出時の PD ネゴシエーションに使用され、基板に必要な電力を取得します。コネクタ 1 は UFP ポートとして構成され、データ ロールはありません。コネクタ 2 は DRP ポートとして構成されています。コネクタ 2 は、コネクタ 1 によって基板に電力が供給されている場合にのみ DFP として動作できます。両方のコネクタが外部電源に接続されている場合、PD の電力供給能力が最も高いポートが基板の電源として選択されます。

PD コントローラは、外部電源を検出し、ソースが 5V で 15W を上回る電力を供給できるかどうかを検出するように構成されています。外部電源が供給できる電力が 5V で 15W 以下の場合、AM62L EVM は電源オフ状態に移行します。

AM62L EVM は、外部電源が 5V で 15W を上回る電力を供給できる場合に電源投入されます。

表 2-1. Type-C ポートの電源ロール

J24 (UFP)	J25 (DRP)	基板電源	注記
接続済み	NC	ON - J17	J17 は UFP で、電力のシンクのみを行います。ペリフェラルが接続されている場合に J19 は DFP として動作します
NC	接続済み	ON - J19	J19 は UFP で、電力のシンクのみを行います
接続済み	接続済み	ON – J17 または J19	基板は、PD の電力供給能力が最も高いポートから電力を供給されます

PD IC は、パワーアップ時に SPI EEPROM を使用して必要な構成をロードし、それによって PD は互換性のある電源と電力供給能力をネゴシエートできます。

構成ファイルは、ヘッダー J21 を使用して EEPROM にロードされます。EEPROM がプログラムされると、PD は SPI 通信を介して構成ファイルを取得します。構成ファイルがロードされると、PD は必要な電源要件を満たすために電源とネゴシエートします。

注

EEPROM には、PD コントローラの動作に必要な構成ファイルがあらかじめプログラムされています。

EVM 基板に電力を供給しているコネクタを識別するために、両方の Type-C コネクタには電源表示 LED が搭載されています。外部電源 (Type-C 出力) は EVM の電源として使用可能ですが、EVM キットには含まれていません。

外部電源の要件 (Type-C) は次のとおりです。

表 2-2. 推奨外部電源

DigiKey 型番	メーカー	メーカー型番
1939-1794-ND	GlobTek, Inc.	TR9CZ3000USBCG2R6BF2
Q1251-ND	Qualtek	QADC-65-20-08CB

注

最小電圧: 5VDC、推奨最小電流: 3000mA
最大電圧: 12VDC、最大電流: 5000mA

AM62L EVM は電源用に USB PD を実装しているため、デバイスと電源アダプタの両方がサポートする最大電圧 / 電流の組み合わせにネゴシエートできます。そのため、電源アダプタが USB-C PD 仕様に準拠している限り、電源が上記の最大電圧と電流の要件を超えても許容されます。

2.4 設定および構成

2.4.1 EVM DIP スイッチ

AM62L EVM には、目的の SoC ブートモードを設定するための 8 ポジション DIP スイッチが 1 つ、4 ポジション DIP スイッチが 2 つ、搭載されています。

2.4.2 ブートモード

ブートモードピンは、デバイスに電源投入する前にブートモードおよびオプションを選択する手段を提供します。各 POR の後、ブートモード ピンがブート パラメータ テーブルに入力するためのメイン ソースになります。評価基板 のブートモードは、図 2-3 に示すように、SW2、SW3、SW4 のスイッチからなる 3 つのバンクによって定義されます。あるいは、テスト オートメーション (XDS110) に接続された I2C バッファによって定義されます。これにより、AM62L SoC のブートモードは、ユーザー (DIP スイッチ制御) またはテスト オートメーション (XDS110) によって制御できます。

スイッチ (SW2、SW3、SW4) のすべてのビットには、弱いプルダウン抵抗と強いプルアップ抵抗があります。オフ設定のときは Low ロジックレベル (「0」) が、オン設定のときは High ロジックレベル (「1」) が提供されます。

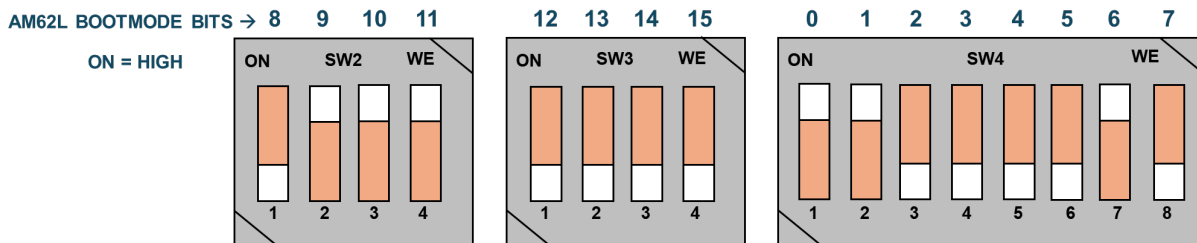


図 2-3. ブートモードスイッチの例 (フル ピン数構成 - SD カード ブート)

SoC のブートモード ピンは、通常動作時には代替機能が関連付けられています。このため、代替ピン機能に対応するために、バッファ IC を使用して分離が可能です。バッファの出力は AM62L SoC のブートモード ピンに接続され、リセット サイクル中にブートモードが必要な場合にのみ出力が有効になります。

バッファへの入力、DIP スイッチ回路と、テスト オートメーション回路によって設定された I2C I/O エクスパンダの出力に接続されています。テスト オートメーション回路がブートモードを制御する場合は、すべてのスイッチを手動でオフ位置に設定できます。ブートモード バッファは、SoC にパワー サイクルが施されてもブート モードが維持されるように、常時オンの電源から電源供給されます。

SoC のブートモードを設定するには、SW4 (BOOTMODE[7:0])、SW2 (BOOTMODE[11:8])、SW3 (BOOTMODE[15:12]) の各スイッチが用いられます。

- BOOTMODE[2:0] - PLL 構成用に ROM コードへのシステム クロック周波数 (WKUP_OSC0_XI/XO) を示します。
- BOOTMODE[6:3] - POR 後に要求されるブートモードを選択するためのプライマリ ブートモードの構成が提供されます。つまり、プライマリ ブート デバイスからブートするペリフェラル / メモリの選択に関する詳細です。
- BOOTMODE[9:7] - これらのピンはプライマリ ブートのためのオプション構成を提供し、選択されたブートモードと組み合わせで使用されます。
- BOOTMODE[12:10] - プライマリ ブート デバイスに障害が発生した場合に、バックアップ ブートモード、つまりブート元となるペリフェラル / メモリを選択します。
- BOOTMODE[13] - このピンは、バックアップ ブート デバイス用のオプション構成を提供します。スイッチ SW3.7 をオンにすると 1 が設定され、オフにすると 0 が設定されます。各デバイスの TRM を参照してください。
- BOOTMODE[15:14] - フル ピン数構成またはピン数削減構成のブートモード マッピングを選択します。

2.4.2.1 ブートモード ピンのマッピング オプション

このデバイスは、次の 2 種類の BOOTMODE ピン マッピング オプションをサポートしています。

1. ピン数削減構成 - ブートストラップ ピン BOOTMODE[15:12] のうち 4 本のみを使用
2. フル ピン数構成 - ブートストラップ ピン BOOTMODE[15:0] の 16 本すべてを使用

フル ピン数構成のブートモード オプションを選択した場合、BOOTMODE[15:0] のすべてのピンをプルアップまたはプルダウンする必要があります。これらのピンをフローティング状態のままにすることはできません。ピン数削減構成のオプションを選択した場合、これは BOOTMODE[15:12] ピンにのみ適用されます。

表 2-3. フル構成と削減構成のブートモード ピンのマッピング

BOOTMODE[15] SW3.4	BOOTMODE[14] SW3.3	ブートモードのマッピング
OFF	OFF	フル ピン数構成
OFF	オン	ピン数削減構成
オン	OFF	
オン	オン	

2.4.2.2 ブートモード ピンのマッピング (ピン数削減構成)

削減構成のマップには、必要なブートストラップ ピンが少なく済むという利点があり、その結果、必要なプルアップ部品やプルダウン部品を減らすことができます。これには、ピンを選択できるブートモード オプションが少なくなるという代償が伴います。

必要なプルアップ / プルダウン部品の必要な低減を実現するため、BOOTMODE[15:14] が「00」でない限り、BOOTMODE[11:0] ピンの入力バッファは POR の間ディスエーブルになります。ピン数削減構成のオプションを使用すると、これらのピンにフローティング入力があるため、消費電力を低減できます。

表 2-4. ブートモード ピンのマッピング (ピン数削減構成)

BOOTMODE[15] SW3.4	BOOTMODE[14] SW3.3	BOOTMODE[13] SW3.2	BOOTMODE[12] SW3.1	プライマリ	予備	PLL 構成
OFF	OFF	x	x	フル ピン数構成オプションを選択します。BOOTMODE[15:0] の入力バッファはイネーブルです		
OFF	オン	OFF	OFF	予約済み		
OFF	オン	OFF	オン	予約済み		
OFF	オン	オン	OFF	ブートなし / デバイスブート	なし	25MHz

表 2-4. ブートモード ピンのマッピング (ピン数削減構成) (続き)

BOOTMODE[15] SW3.4	BOOTMODE[14] SW3.3	BOOTMODE[13] SW3.2	BOOTMODE[12] SW3.1	プライマリ	予備	PLL 構成
OFF	オン	オン	オン	USB0	UART	25MHz
オン	OFF	OFF	OFF	eMMC	USB DFU	25MHz
オン	OFF	OFF	オン	QSPI	UART	25MHz
オン	OFF	オン	OFF	MMC / SD カード	UART	25MHz
オン	OFF	オン	オン	eMMC	MMC1/SD カード	25MHz
オン	オン	OFF	OFF	OSPI	UART	25MHz
オン	オン	OFF	オン	SPI	UART	25MHz
オン	オン	オン	OFF	UART	MMC1/SD カード	25MHz
オン	オン	オン	オン	USB DFU	MMC1/SD カード	25MHz

2.4.2.3 ブートモード ピンのマッピング (フル ピン数構成)

これにより、フレキシビリティが向上し、ブート元のペリフェラルが増加します。

ブートモード機能 (フル ピン数構成) へのスイッチ マッピングを、次の表に示します。

表 2-5. ブートモード ピンのマッピング (フル ピン数構成)

Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
0	0	バックアップ ブートモ ード構 成	バックアップ ブートモード			プライマリ ブートモード構 成			プライマリ ブートモード			PLL の構成			

表 2-6 に、PLL リファレンス クロック選択の詳細を示します。

表 2-6. PLL リファレンス クロックの選択 BOOTMODE[2:0]

BOOTMODE[2] SW4.3	BOOTMODE[1] SW4.2	BOOTMODE[0] SW4.1	PLL REF CLK (MHz)
OFF	OFF	OFF	予約済み
OFF	OFF	オン	予約済み
OFF	オン	OFF	24
OFF	オン	オン	25
オン	OFF	OFF	26
オン	OFF	オン	予約済み
オン	オン	OFF	予約済み
オン	オン	オン	予約済み

表 2-7 に、プライマリ ブート メディアの構成の詳細を示します。

表 2-7. ブート デバイス選択 BOOTMODE[6:3]

BOOTMODE[6] SW4.7	BOOTMODE[5] SW4.6	BOOTMODE[4] SW4.5	BOOTMODE[3] SW4.4	プライマリ ブート デバイスの 選択
OFF	OFF	OFF	OFF	シリアル NAND
OFF	OFF	OFF	オン	OSPI
OFF	OFF	オン	OFF	QSPI
OFF	OFF	オン	オン	SPI
OFF	オン	オン	オン	UART
オン	OFF	OFF	OFF	MMCSD ブート (UDAを使用する SD カード ブートまたは eMMC ブート)

表 2-7. ブート デバイス選択 BOOTMODE[6:3] (続き)

BOOTMODE[6] SW4.7	BOOTMODE[5] SW4.6	BOOTMODE[4] SW4.5	BOOTMODE[3] SW4.4	プライマリ ブート デバイスの 選択
オン	OFF	OFF	オン	eMMC ブート
オン	OFF	オン	OFF	USB
オン	OFF	オン	オン	GPMC NAND
オン	オン	OFF	オン	Fast-xSPI
オン	オン	オン	OFF	xSPI
オン	オン	オン	オン	ブートなし / デバイス ブート

表 2-8 に、プライマリ ブート メディアの構成の詳細を示します。

表 2-8. プライマリ ブート メディアの構成 BOOTMODE[9:7]

BOOTMODE[9] SW2.2	BOOTMODE[8] SW2.1	BOOTMODE[7] SW4.8	ブート デバイス
予約済み	読み取りモード 2	読み取りモード 1	シリアル NAND
予約済み	予約済み	チップ選択	OSPI
予約済み	予約済み	チップ選択	QSPI
予約済み	モード	チップ選択	SPI
予約済み	予約済み	予約済み	UART
ポート	予約済み	サンプリング周波数 / 生データ	MMCSD ブート (UDA を使用する SD カード ブート または eMMC ブート)
予約済み	予約済み	予約済み	eMMC ブート
予約済み	モード	レーン スワップ	USB
予約済み	予約済み	予約済み	GPMC NAND
予約済み	予約済み	予約済み	Fast-xSPI
SFDP	読み取りコマンド	モード	xSPI
予約済み	予約済み	なし / デバイス	ブートなし / デバイス ブート

表 2-9 に、バックアップ ブート モードの選択の詳細を示します。

表 2-9. バックアップ ブート モードの選択 BOOTMODE[13:10]

BOOTMODE[13] SW3.2	BOOTMODE[12] SW3.1	BOOTMODE[11] SW2.4	BOOTMODE[10] SW2.3	バックアップ ブート デバイス の選択
予約済み	OFF	OFF	OFF	なし (バックアップ モードな し)
モード	OFF	OFF	オン	USB
予約済み	OFF	オン	OFF	予約済み
予約済み	OFF	オン	オン	UART
ポート	オン	OFF	オン	MMC/SD
予約済み	オン	オン	OFF	SPI

表 2-10. シリアル NAND 構成フィールド

ブートモード ピン	フィールド	値	説明
8 [SW2.1]	読み取りモード 2	0	予約済み (読み取りモードは読み取りモード 1 から取得)
		1	SPI/ 1-1-1 モード (読み取りモードは、読み取りモード 2 から取得され読み取りモード 1 は無視されます。)

表 2-10. シリアル NAND 構成フィールド (続き)

ブートモードピン	フィールド	値	説明
7 [SW4.8]	読み取りモード 1	0	OSPI/ 1-1-8 モード (読み取りモード 2 が 0 の場合のみ有効)
		1	OSPI/ 1-1-4 モード (読み取りモード 2 が 0 の場合のみ有効)

表 2-11. OSPI ブート構成フィールド

ブートモードピン	フィールド	値	説明
7 [SW4.8]	チップ選択	0	ブートフラッシュは CS 0 に搭載
		1	ブートフラッシュは CS 1 に搭載

表 2-12. QSPI ブート構成フィールド

ブートモードピン	フィールド	値	説明
7 [SW4.8]	チップ選択	0	ブートフラッシュは CS 0 に搭載
		1	ブートフラッシュは CS 1 に搭載

表 2-13. SPI ブート構成フィールド

ブートモードピン	フィールド	値	説明
8 [SW2.1]	モード	0	SPI モード 0
		1	SPI モード 3
7 [SW4.8]	チップ選択	0	ブートフラッシュは CS 0 に搭載
		1	ブートフラッシュは CS 1 に搭載

表 2-14. SD カード ブート構成フィールド

ブートモードピン	フィールド	値	説明
9 [SW2.2] 13 ⁽¹⁾ [SW3.2]	ポート	0	予約済み
		1	MMC ポート 1 (4 ビット幅)。このビットは 1 に設定する必要があります
7 [SW4.8]	FS/Raw	0	ファイルシステム モード
		1	Raw モード

(1) MMCSD がバックアップ モードの場合

表 2-15. eMMC ブート構成フィールド

ブートモードピン	フィールド	値	説明
9 [SW2.2] 13 [SW3.2]	ポート	0	MMCSD ポート 0 (8 ビット幅)。このビットは 0 に設定する必要があります
		1	予約済み
7 [SW4.8]	FS/Raw	0	ファイルシステム モード
		1	Raw モード

表 2-16. USB ブート構成フィールド

ブートモードピン	フィールド	値	説明
9 [SW2.2]	コア電圧	0	予約済み
		1	
8 [SW2.1] 13 ⁽¹⁾ [SW3.2]	モード	0	DFU (USB デバイス ファームウェア アップグレード)
		1	ホスト (MSC ブート)
7 [SW4.8]	レーン スワップ	0	D+/D- ラインはスワップされていません
		1	D+/D- ラインがスワップされています

(1) USB がバックアップ モードの場合。

表 2-17. xSPI ブート構成フィールド

ブートモードピン	フィールド	値	説明
9 [SW2.2]	SFDP	0	SFDP はディセーブル
		1	SFDP はイネーブル
8 [SW2.1]	読み取りコマンド	0	0x0B 読み取りコマンド
		1	0xEE 読み取りコマンド
7 [SW4.8]	モード	0	1S-1S-1S モード (50MHz)
		1	8D-8D-8D モード (25MHz)

2.4.2.4 ブートモード DIP スイッチ構成 (フルピン数)

2.4.2.4.1 1 次側:SD カード、バックアップ:UART_0x0E43

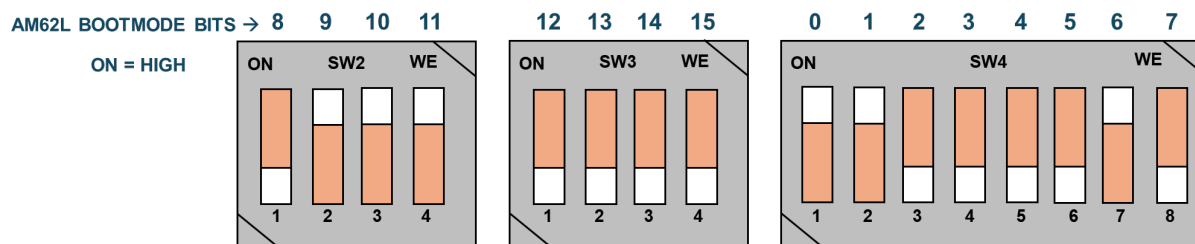


図 2-4. MMCSD/UART バックアップ用のブートモードスイッチの構成

2.4.2.4.2 プライマリ:xSPI SFPD 1、バックアップ:UART_0x0E73

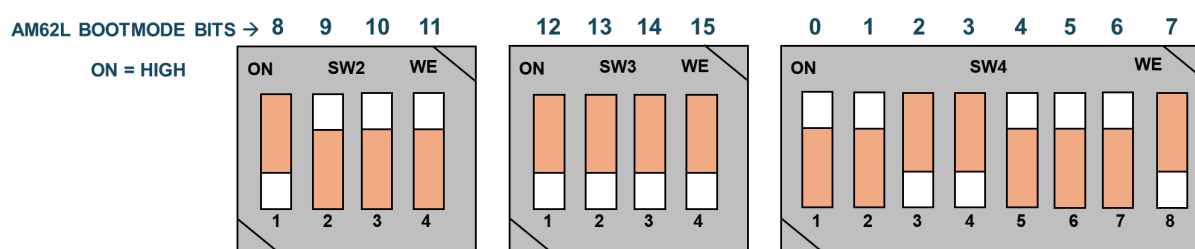


図 2-5. xSPI/UART バックアップ用のブートモードスイッチの構成

2.4.2.4.3 1 次側:NOBOOT、バックアップ:None_0x00FB

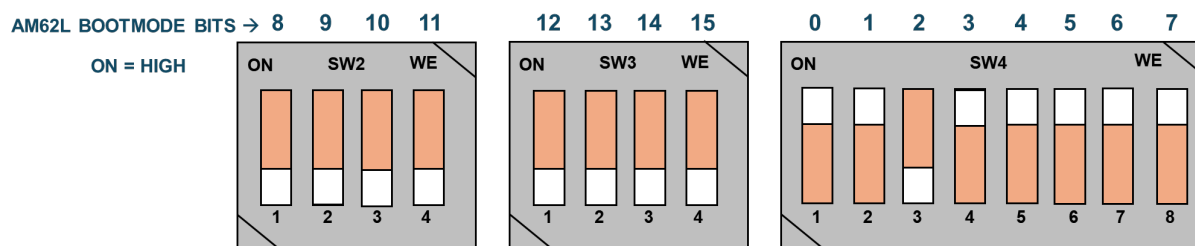


図 2-6. NOBOOT (DEVBOOT = 0) / バックアップなし用のブートモードスイッチの構成

2.4.2.4.4 1 次側:GPMC NAND の元のタイミング、バックアップ:USB_DFU_0x04DB

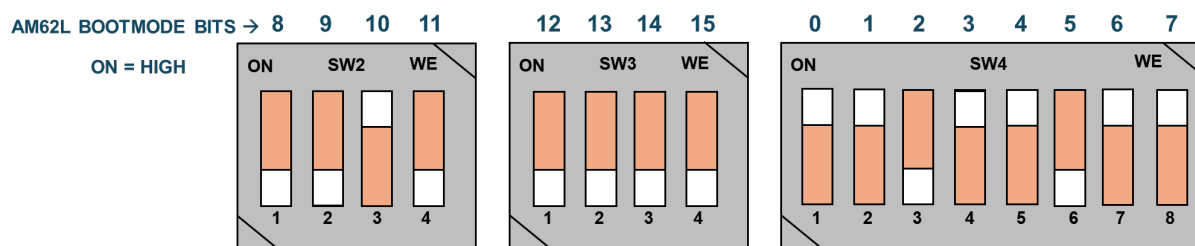


図 2-7. GPMC NAND/USB バックアップ用のブートモードスイッチの構成

2.4.2.4.5 次側:GPMC NAND の元のタイミング、バックアップ:UART_0x0CDB

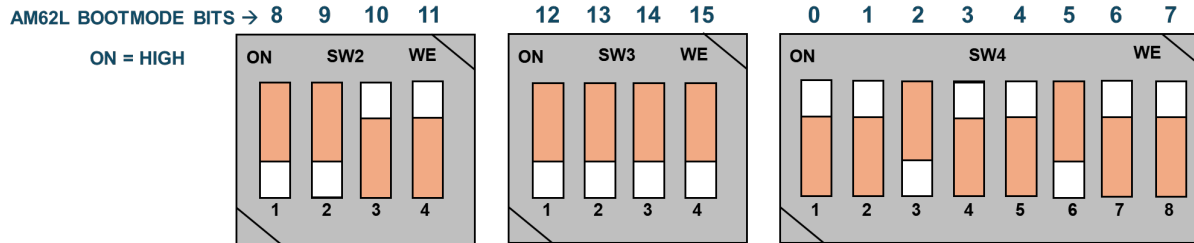


図 2-8. GPMC NAND/UART バックアップ用のブートモード スイッチの構成

2.4.2.4.6 プライマリ:eMMC、バックアップ:SD_card_0x344B

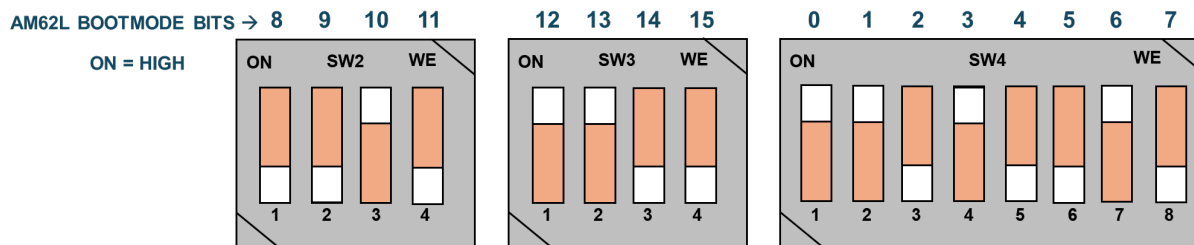


図 2-9. eMMC/MMCSD バックアップ用のブートモード スイッチの構成

2.4.3 ユーザー テスト LED

AM62L EVM 基板には、ユーザー定義による機能用に 2 つの LED が搭載されています。

表 2-18 に、ユーザー テスト LED と、その制御に使用される関連 GPIO を示します。

表 2-18. ユーザー テスト LED

シリアル番号	LED	使用した GPIO	SCH ネット名
1	LD8	GPIO0_123	SOC_GPIO0_123
2	LD2	U11.24(P27)	IO_EXP_TEST_LED

2.5 電源オン / オフの手順

評価基板への電力供給は、2 つの USB Type-C® ポートのいずれかによって、PD 機能を備えた外部電源から行われます。

注

テキサス・インスツルメンツでは、I/O ケーブルの最大長が 3m を超えないことを推奨します。

2.5.1 電源オンの手順

1. 評価基板ブート スイッチ セレクタ (SW4、SW3、SW2) を選択したブートモードに設定します。図 2-10 に、SD カードのフル ピン数構成のブートモードの例を示します。
2. ブート メディアを接続します (該当する場合)。
3. PD 対応の USB Type-C ケーブルを、評価基板の Type-C (J17 または J19) コネクタに取り付けます。
4. Type-C ケーブルのもう一方の端を AC 電源アダプタまたは Type-C ソース デバイス (ノートコンピュータなど) に接続します。
5. LD6 LED が点灯していること、および LD8 または LD11 の LED も点灯していることを目視で確認します。
6. XDS110 JTAG と UART のデバッグ コンソール出力は、それぞれ micro-USB ポート J8 と J7 に接続されています。

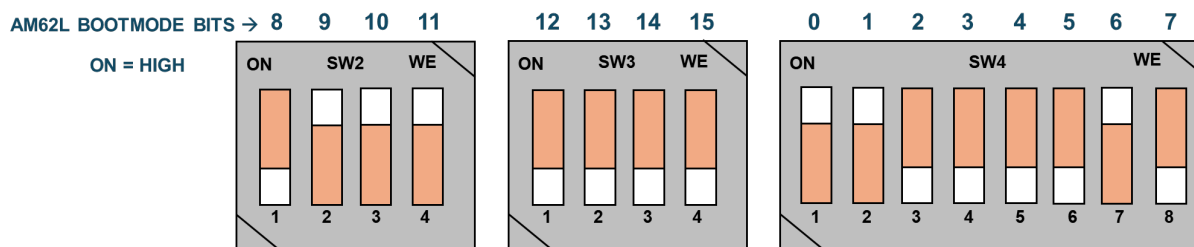


図 2-10. フルピン数構成のブートモード (SD カード ブート) の例

2.5.2 電源オフの手順

1. AC/DC コンバータから AC 電源を切り離します。
2. EVM から USB Type-C ケーブルを取り外します。

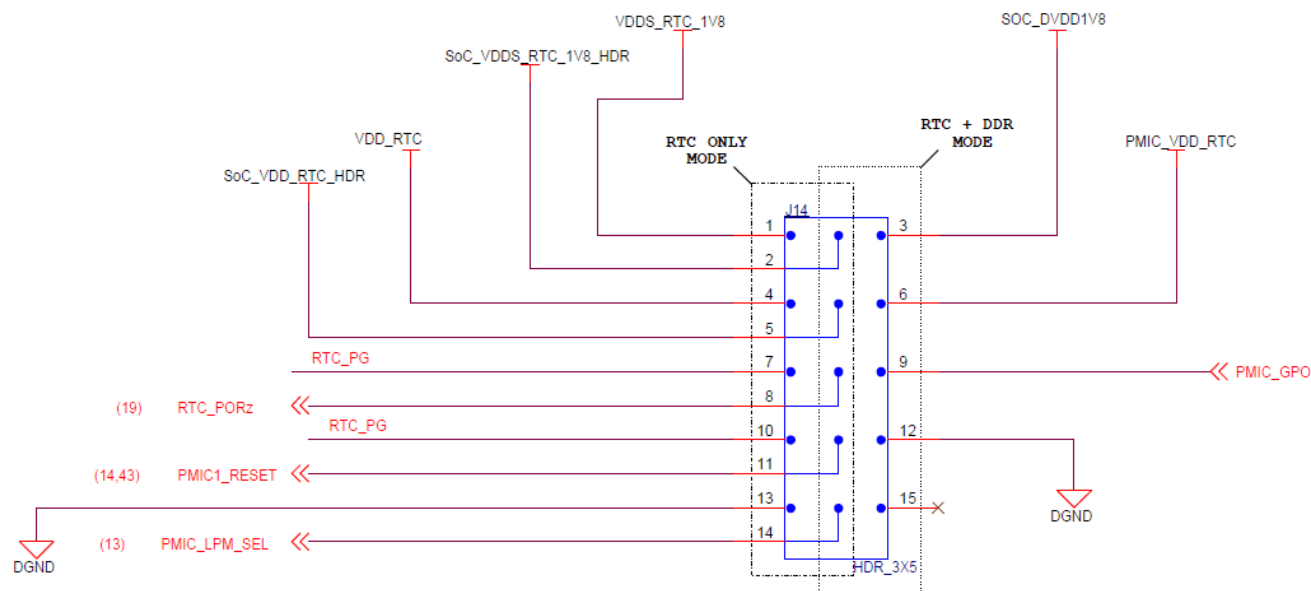
2.5.3 RTC 電源選択ヘッダ

RTC 電源選択ヘッダは 5x3 ヘッダであり、図 2-11 に示すように、5x2 のメスギヤングジャンパを使用して、RTC 専用モードまたは RTC + DDR モードのいずれかを選択するために使用できます。

注

低消費電力モードをサポートするために必要な接続の詳細については、『AM62L の電源実装』アプリケーションノート (AM62L の電源実装) を参照してください。

RTC SUPPLY SELECTION



Note: Use 5x2 Female gang jumper to select the mode

図 2-11. RTC 電源選択ヘッダ

表 2-19 に、RTC 電源選択ヘッダのピン配置の詳細を示します。

表 2-19. 15 ピン RTC 電源選択ヘッダ (J14)

ピン番号	ネット名
1	VDDS_RTC_1V8
4	VDD_RTC
7	RTC_PG
10	RTC_PG
13	DGND
2	SoC_VDDS_RTC_1V8_HDR
5	SoC_VDD_RTC_HDR
8	RTC_PORz
11	PMIC1_RESET (PMIC 1 に対して)
14	PMIC_LPM_SEL
3	SOC_DVDD1V8
6	PMIC_VDD_RTC
9	PMIC_GPO
12	DGND
15	NC

2.5.4 RTC 専用モード

RTC 専用モードは、デバイスの RTC ドメインのみがアクティブで MAIN ドメインは非アクティブの、低消費電力モードです。

RTC 専用モードでは、SoC の RTC 電源および RTC_PORz は外部のディスクリート LDO から供給されるとともに、PMIC の電源オフ用の PMIC_EN を制御するために使用される SoC からの PMIC_LPM_EN0 信号出力から供給されます。

RTC 専用モードでは、時刻とカレンダー情報を維持できます。

2.5.5 RTC + DDR モード

RTC+DDR モードでは、MAIN I/O ドメインおよび RTC 電源ドメインの両方がアクティブのままです。SoC からの PMIC_LPM_EN0 信号出力は、PMIC のスタンバイ モードのイネーブル / ディスエーブルに使用されます。スタンバイ モードがイネーブルの場合、PMIC は VDD_CORE および VDDA_1V8 からの出力をディスエーブルします。PMIC からの RTC、DDR、I/O 電源はアクティブのままです。スタンバイ モードがディスエーブルの場合、すべての PMIC 出力がアクティブになります。

2.5.6 電力テストポイント

基板上的各電力出力のテストポイントを、表 2-20 に示します。

表 2-20. 電力テストポイント

シリアル番号	電源	テストポイント	電圧
1	VCC5V0_EXP	TP24	5
2	VCC3V3_EXP	TP25	3.3
3	VDD_1V0	TP132	1
4	VDD_1V2	TP41	1.2
5	VDDS_RTC_1V8	TP200	1.8
6	VDD_RTC	TP85	0.75
7	VPP_1V8	TP95	1.8
8	VDD_2V5	TP44	2.5
9	VDD_CORE	TP86	0.75

表 2-20. 電力テスト ポイント (続き)

シリアル番号	電源	テスト ポイント	電圧
10	PMIC_VDD_RTC	TP97	0.75
11	VCC1V8_SYS	TP92	1.8
12	VDDA_1V8	TP101	1.8
13	VDD_LPDDR4	TP90	1.1
14	VCC_3V3_SYS	TP202	3.3
15	VCC_3V3_MAIN	TP102	3.3
16	VMAIN	TP112	12
17	VCC_5V0	TP117	5
18	VCC3V3_XDS	TP66	3.3
19	XDS_USB_VBUS	TP56	5
20	VCC3V3_TA	TP201	3.3
21	VBUS_5V0_TYPEA	TP91	5
22	VBUS_TYPEC1	TP111	12
23	VBUS_TYPEC2	TP120	12
24	FT4232_USB_VBUS	TP37	5
25	LDO_3V3	U61.8	3.3
26	VCC_3V3_FT4232	C20.2	3.3
27	VDD_MMC1_SD	TP174	3.3
28	VCC_5V0_HDMICONN	TP161	5

2.6 インターフェイス

以下のセクションでは、AM62L EVM のさまざまなインターフェイスと回路の概要について説明します。表 2-21 に、AM62L EVM のインターフェイス マッピングを示します。

2.6.1 AM62L EVM のインターフェイス マッピング

表 2-21. インターフェイス マッピング

インターフェイス名	SoC 上のポート	デバイス部品番号
メモリ - LPDDR4	DDR0	MT53E1G16D1ZW-046 WT:C
メモリ - OSPI NOR	OSPI0	S28HS512TGABHM013
メモリ - QSPI NAND	OSPI0	W25N01JWTBAG
メモリ - Micro SD ソケット	MMC1	MEM2051-00-195-00-A
メモリ - eMMC	MMC0	MTFC32GBCAQTC-IT
メモリ - 基板 ID EEPROM	SoC_I2C0	AT24C512C-MAHM-T
イーサネット 1 - RGMII	SoC_RGMII1	DP83867IRRGZ
イーサネット 2 - RGMII	SoC_RGMII2	DP83867IRRGZ
GPIO ポート エクスパンダ 1	SoC_I2C1	TCA6424ARGJR
GPIO 拡張コネクタ - 2x5 HDR	UART2, VCC3V3, VCC5V0, GPIO	67997-410HLF
GPIO 拡張コネクタ - 2x15 HDR	SPI1, SPI3, UART4, I2C3, GPIO	PREC015DAAN-RC
USB -2.0 Type C	USB0	2012670005
USB -2.0 Type A	USB1	629104151021
DSI インターフェイス	DSI0-TX	5019512230
3 個の MCAN インターフェイス	MCAN0, MCAN1 および MCAN2	TSM-104-02-L-SV
HDMI	VOUT0, McASP0and, SoC_I2C1	SiI9022ACNU + TPD12S016PWR + DC04S019JA1R600
オーディオ コーデック	McASP0 および SoC_I2C1	TLV320AIC3106IRGZT+ SJ-43514-SM

表 2-21. インターフェイス マッピング (続き)

インターフェイス名	SoC 上のポート	デバイス部品番号
GPIO ポート エクスパンダ 2	SoC_I2C1	TCA6424ARGJR
UART 端子 (UART-to-USB)	SoC_UAR SoC_UART[1:0], WKUP_UART0, SoC_UART4	FT4232HL + 629105150521
温度センサ	SoC_I2C1	TMP100NA/3K
電流モニタ	SoC_I2C1	INA228AIDGSR
コネクティビティ - M.2 Key E	MMC2, McASP0, SoC_UART1	2199119-4

2.6.2 DSI インターフェイス

AM62L SoC の DSI ディスプレイ インターフェイスは、Molex の 22 ピン ディスプレイ コネクタ (J23) (メーカー型番 5019512230) に接続されています。AM62L EVM は、最大 1920x1080p (60fps) の解像度の高速ビデオリンクおよび低消費電力コマンドリンク向けに 4 つの DSI-TX レーンをサポートしています。これら 4 つのレーンを除き、22 ピン コネクタには 3.3V 電源が供給され、500mA までのソース機能、すべての事前初期化用の I2C0、インターフェイス ディスプレイへの割り込みおよびリセットを処理するための 2 つの GPIO があります。

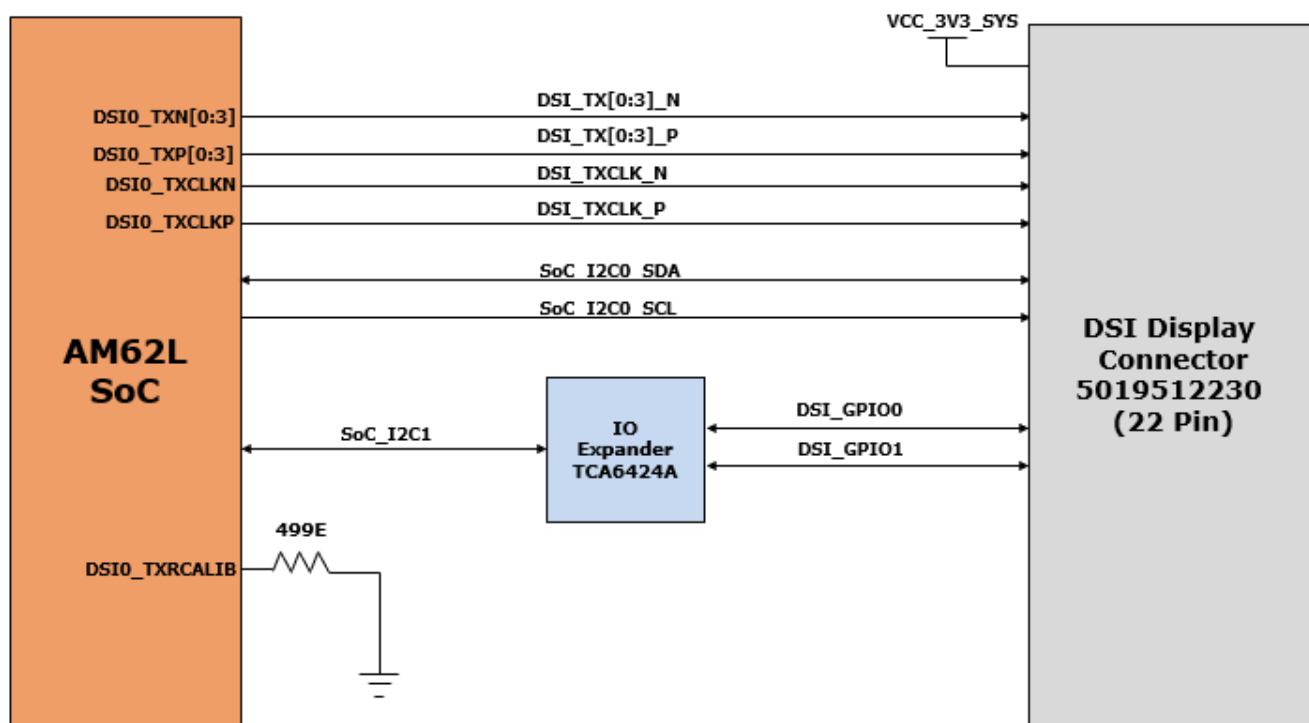


図 2-12. DSI インターフェイスのブロック図

表 2-22 に、ディスプレイ コネクタのピン配置の詳細を示します。

表 2-22. DSI ディスプレイ コネクタのピン配置 (J23)

ピン番号	信号
1	VCC_3V3_SYS
2	SOC_I2C0_SDA
3	SOC_I2C0_SCL
4	DGND
5	DSI_GPIO1
6	DSI_GPIO0

**表 2-22. DSI ディスプレイコ
ネクタのピン配置 (J23) (続
き)**

ピン番号	信号
7	DGND
8	DSI_TX3_P
9	DSI_TX3_N
10	DGND
11	DSI_TX2_P
12	DSI_TX2_N
13	DGND
14	DSI_TXCLK_P
15	DSI_TXCLK_N
16	DGND
17	DSI_TX1_P
18	DSI_TX1_N
19	DGND
20	DSI_TX0_P
21	DSI_TX0_N
22	DGND

2.6.3 オーディオコーデックインターフェイス

AM62L EVM には、McASP0 の信号グループ経由で AM62L とインターフェイスできるように、TI の TLV320AIC3106 ステレオ オーディオ コーデックが搭載されています。

TLV320AIC3106 は、ステレオ ヘッドフォン アンプを内蔵した低消費電力ステレオ オーディオ コーデックであり、シングルエンドまたは完全差動構成でプログラマブルな複数の入力と出力を備えています。TLV320AIC3106 の録音パスには、内蔵マイクロフォン バイアス、デジタル制御のステレオ マイク プリアンプ、自動ゲイン制御 (AGC) が含まれており、複数のアナログ入力の間に MIX および MUX 機能があります。ステレオ オーディオ DAC は、8kHz ~ 96kHz のサンプリングレートをサポートします。

MIC IN とヘッドフォン出力用に、標準的な 3.5mm TRRS オーディオ ジャック コネクタ (J20) (メーカー型番 SJ-43514) が 1 個付属しています。オーディオ コーデックのライン入力は、テスト ポイントに終端しています。コーデックは I2C1 を介して構成し、デバイス アドレスを 0x1B に設定できます。

オーディオ コーデックへのコントローラ クロック入力である MCLK は、12.288MHz の発振器から供給されます。オーディオ シリアル データ バス ビット クロック (BCLK) とオーディオ シリアル データ バス入出力 (DIN および DOUT) は、マルチプレクサ / デマルチプレクサを経由して SOC の MCASP0 インスタンスに接続されます。RESETSTATz の AND 出力と、I/O エクスパンダ経由で供給される GPIO は、オーディオ コーデックをリセットするために使用されます。

TLV320AIC3106 は、3.3V のアナログ電源、1.8V のデジタルコア電源、3.3V のデジタル I/O 電源で動作します。

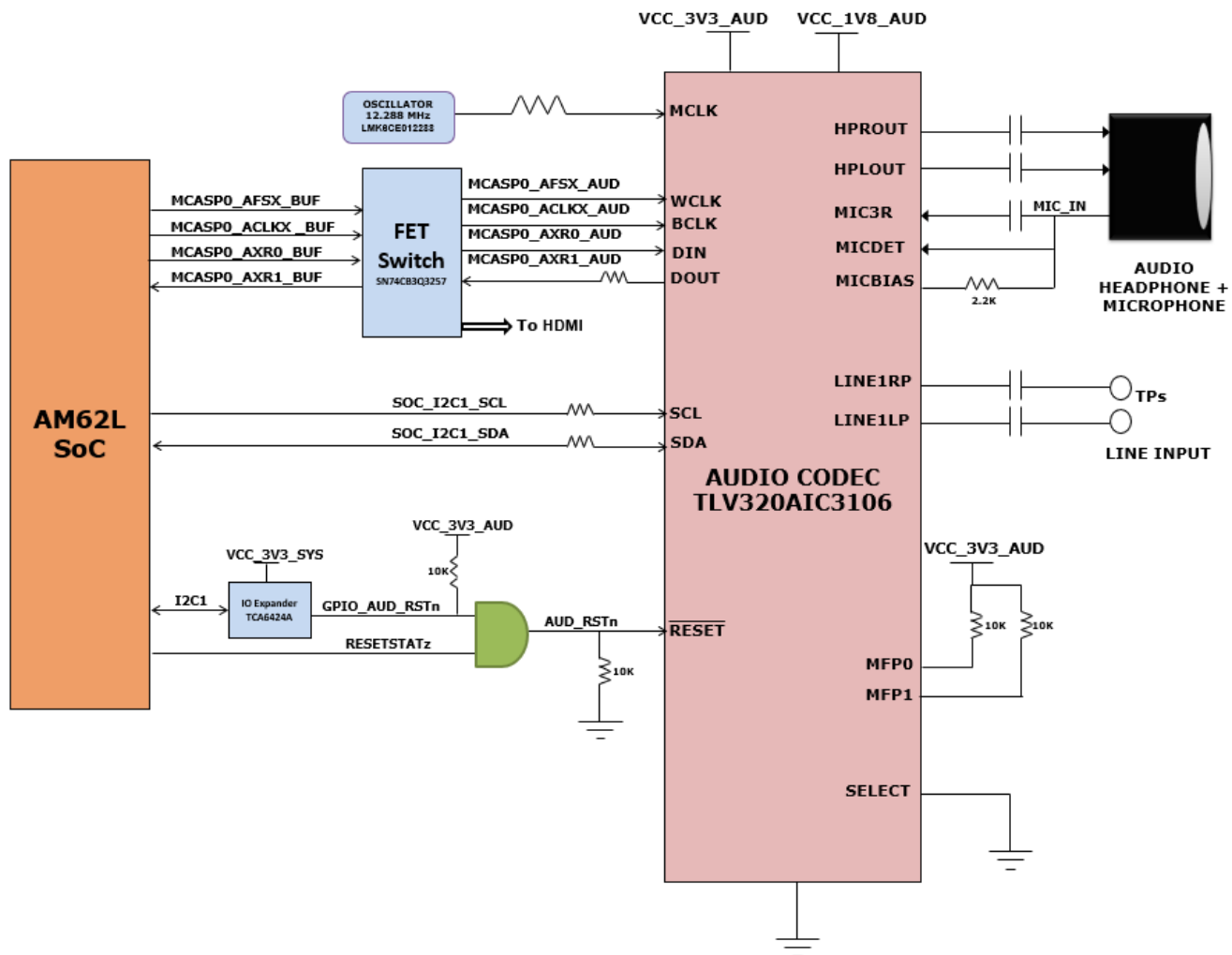


図 2-13. オーディオ コーデック インターフェイスのブロック図

2.6.4 HDMI ディスプレイ インターフェイス

AM62L SoC の DSS (ディスプレイ サブ システム) は、評価基板上で使用され、標準的な Type-A コネクタ経由で HDMI インターフェイスを実現します。この評価基板は、Lattice Semiconductor の SiI9022A HDMI トランスミッタを搭載しており、24 ビットの平行 RGB DSS 出力ストリームおよび McASP0 信号を HDMI 準拠のデジタル オーディオ/ビデオ信号に変換します。

SiI9022A を使用するには、SoC がデバイスをセットアップする必要があります。これは、SoC と SiI9022A の間の I2C1 インターフェイスを介して行われます。HDMI トランスミッタに接続された SoC_I2C1 インスタンスは、互換モードレジスタ、TPI レジスタ、CPI レジスタにアクセスします。オーディオ データは、McASP0 インスタンスを介して SoC から HDMI トランスミッタに送信されます。HDMI_I2C バスは、接続されたシンク デバイスの EDID と HDCP データにアクセスします。

TMD5 差動データ ペアとトランスミッタからの差動クロック信号は、HDMI ESD デバイス (メーカー型番 TPD12S016PWR) 経由で HDMI コネクタに接続されています。このデータは、オンボードの 5V 電源から HDMI コネクタに供給される電流を制限するロード スイッチとしても機能します。

HDMI フレーマには、3.3V 基板 I/O 電源から給電されます。また、専用 LDO (メーカー型番 TLV75512PDQNR) から、AVCC および DVCC 電源用の 1.2V が給電されます。

FET スイッチは、HDMI トランスミッタまたは GPIO 拡張ヘッダへの DSS ビデオ信号を選択するのに使用されます。デフォルトでは、DSS ビデオ信号は HDMI トランスミッタに接続され、J29 1x2 ヘッダを短絡することによって、ソフトウェアに依存せずに GPIO 拡張ヘッダに選択を変更できます。

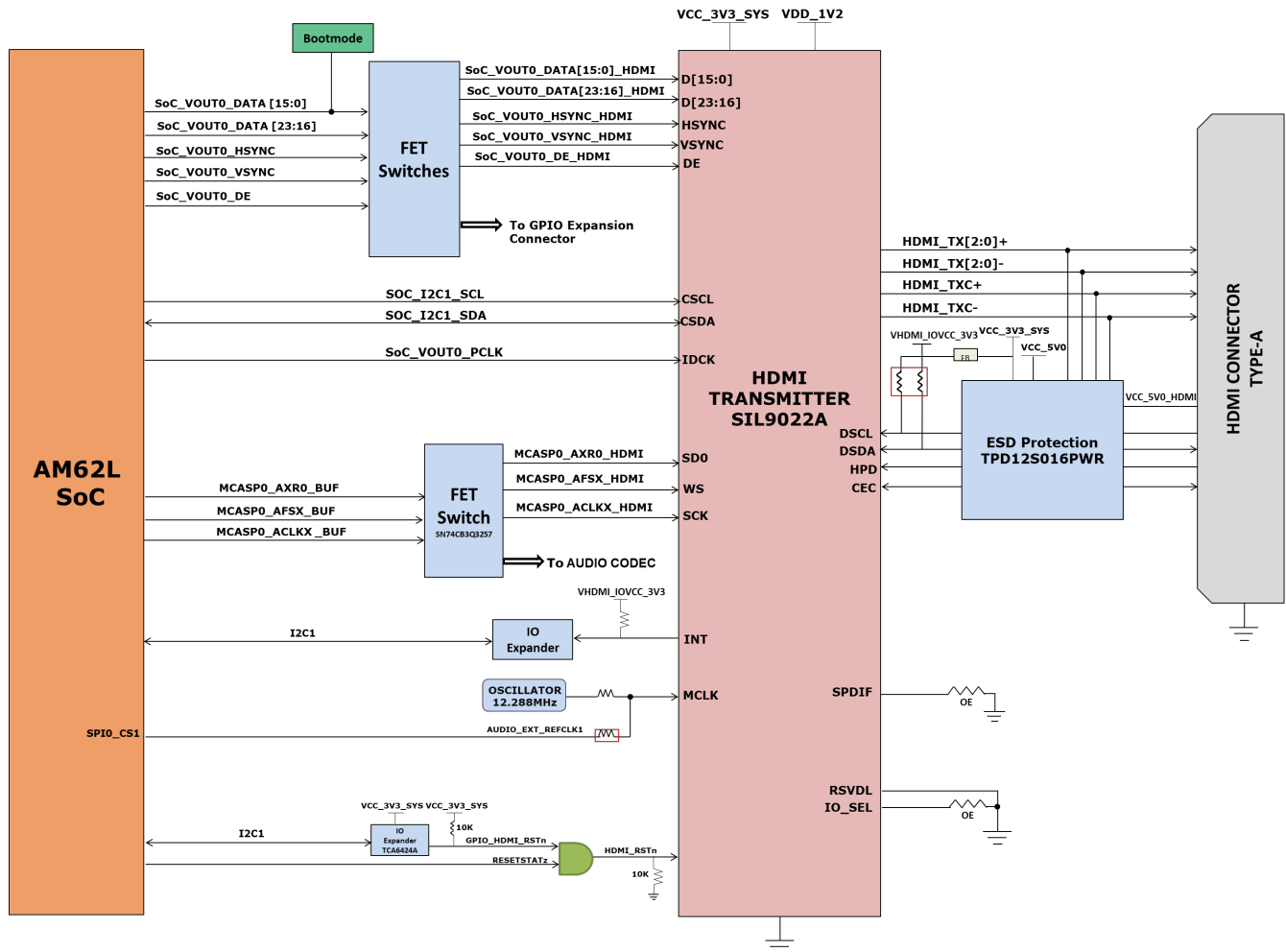


図 2-14. HDMI インターフェイスのブロック図

2.6.5 JTAG インターフェイス

AM62L EVM には、XDS110 クラスのオンボード エミュレーション機能が搭載されています。このエミュレータの接続には標準的な USB 2.0 micro-B コネクタが使用され、回路はバス電源供給方式の USB デバイスとして機能します。コネクタからの VBUS 電源はエミュレーション回路に電源として使用されているため、EVM 電源が切り離されてもエミュレータへの接続が失われることはありません。電圧変換バッファは、XDS110 回路を EVM の他の部分から分離するために使用されます。

オプションとして、評価基板の JTAG インターフェイスは、20 ピンの標準 JTAG cTI ヘッダ J10 を通じて提供されます。これにより、外部 JTAG エミュレータ ケーブルを接続できます。電圧変換バッファは、cTI ヘッダの JTAG 信号を評価基板の他の部分から分離するために使用されます。XDS110 セクションと cTI ヘッダー セクションの電圧トランスレータの出力はマルチプレクサによって切り替えられ、AM62L の JTAG インターフェイスに接続されています。自動存在検出回路を使用して cTI 20 ピン JTAG コネクタへの接続が検出されると、マルチプレクサはオンボードのエミュレーション回路の代わりに cTI コネクタからの 20 ピン信号を AM62L SoC にルーティングします。

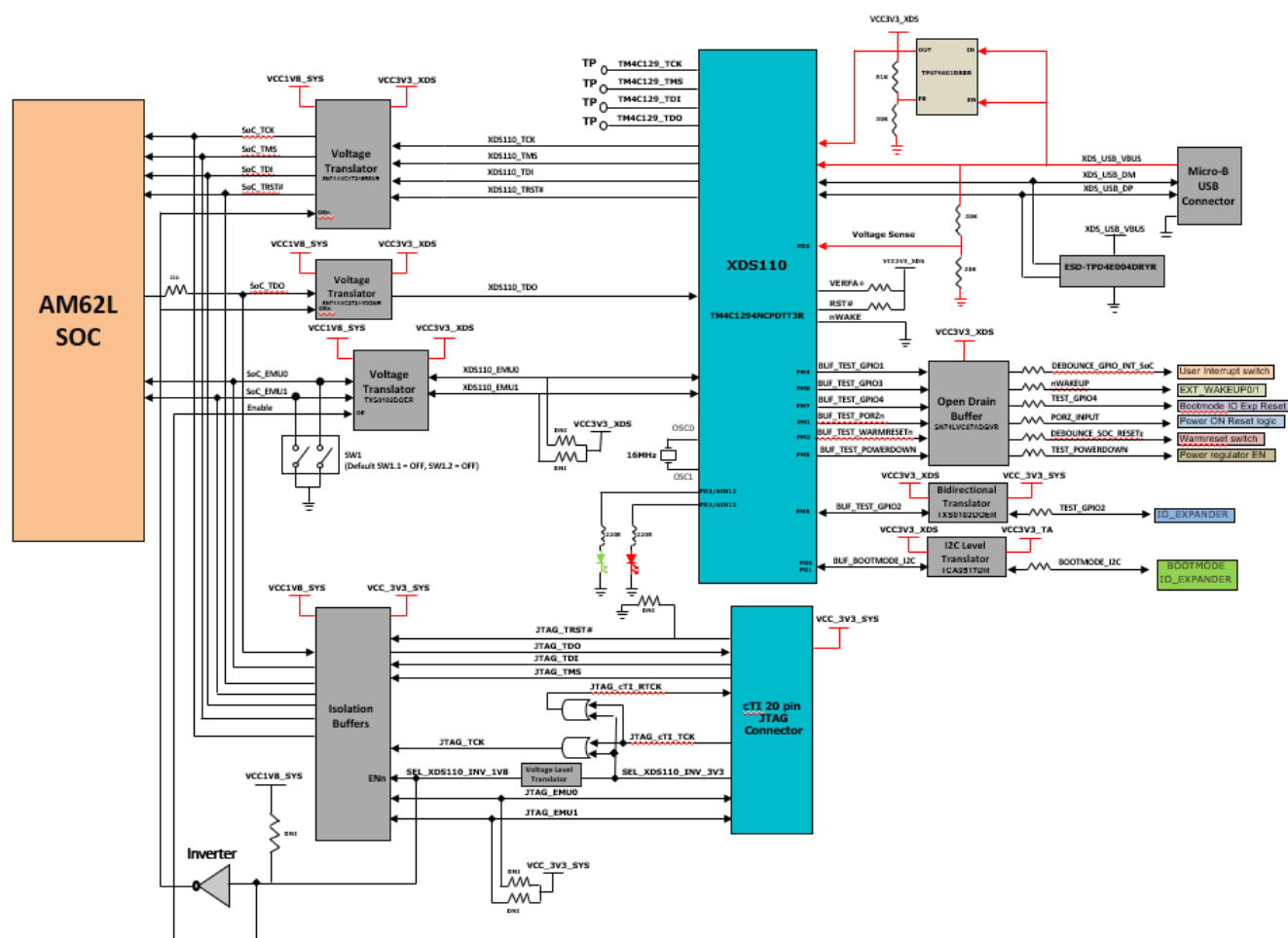


図 2-15. JTAG インターフェイスのブロック図

表 2-23 に、cTI 20 ピン JTAG コネクタのピン配列を示します。USB 信号には、ESD 電流パルスを VCC または GND に誘導する ESD 保護デバイス (型番 TPD4E004) が用いられています。TPD4E004 は、IEC 61000-4-2 で規定されている最大 $\pm 15\text{kV}$ の人体モデル (HBM) の ESD パルスから保護し、 $\pm 8\text{kV}$ の接触放電と $\pm 12\text{kV}$ のエアギャップ放電を提供します。

表 2-23. JTAG コネクタ (J10) のピン配置

ピン番号	信号
1	JTAG_TMS
2	JTAG_TRST#
3	JTAG_TDI
4	JTAG_TDIS
5	VCC_3V3_SYS
6	NC
7	JTAG_TDO
8	SEL_XDS110_INV_3V3
9	JTAG_cTI_RTCK
10	DGND
11	JTAG_cTI_TCK
12	DGND
13	JTAG_EMU0
14	JTAG_EMU1

表 2-23. JTAG コネクタ (J10) のピン配置 (続き)

ピン番号	信号
15	JTAG_EMU_RSTn
16	DGND
17	NC
18	NC
19	NC
20	DGND

2.6.6 XDS110 テスト オートメーション

AM62L EVM は、テスト オートメーションと呼ばれるオプション機能を備えており、パワーダウン、POR、ウォームリセット、ブートモード制御などいくつかの基本的な動作を外部コントローラから XDS110 経由で操作できます。

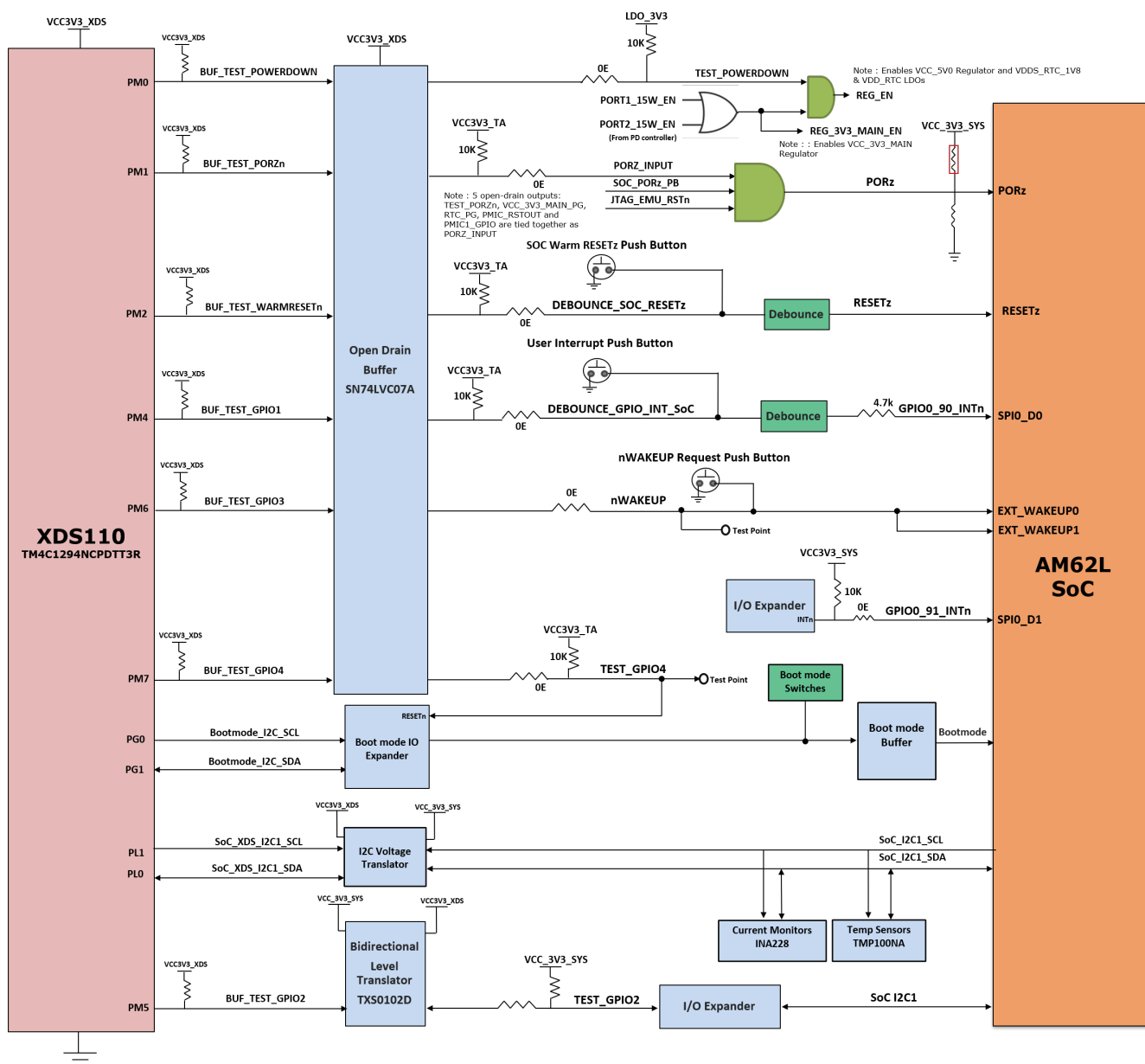


図 2-16. テスト オートメーション インターフェイスのブロック図

XDS110 テスト オートメーションには電圧変換回路があり、コントローラは AM62L で使用される I/O 電圧から絶縁されています。AM62L のブートモードは、DIP スイッチまたは I2C I/O エクスパンダによる XDS テスト オートメーションを使用して、ユーザーが制御できます。ブートモード バッファは、DIP スイッチまたは I2C I/O エクスパンダによって駆動されるブートモード制御を分離するために使用されます。ブートモードは、ボード上の 1 つの 8 ビット DIP スイッチと 2 つの 4 ビット DIP スイッチを使用して設定することもでき、スイッチが ON 位置に設定されている場合はプルアップ抵抗をバッファの出力に、OFF 位置に設定されている場合は弱いプルダウン抵抗に接続します。バッファの出力は AM62L SoC のブートモードピンに接続され、リセット サイクル中にブートモードが必要な場合にのみ出力が有効になります。

XDS110 テスト オートメーションによってブートモードを設定する場合、必要なスイッチ値が I2C I/O エクスパンダ出力に設定されます。これにより、DIP スイッチ値が書き込まれ、SoC に目的のブート値が得られます。ブートモード用に使用されるピンにはそれ以外の機能もあるため、これらは、通常動作時にブートモード バッファをディスエーブルにすることによって自動的に分離されます。

XDS110 からのパワーダウン信号は、ボード上の専用電源を除くすべてのレールをパワーダウンするように評価基板に指示します。同様に、PORZn 信号は SoC にハードリセットを行い、WARMRESETn は SoC にウォームリセットを行います。

2.6.7 UART インターフェイス

SoC の 4 つの UART ポート (WKUP UART0、SoC UART0、SoC UART1、SoC UART4) は、USB-to-UART 機能を実現するために FTDI ブリッジ FT4232HL とインターフェイスされ、基板上の micro-B USB コネクタ (J7) で終端されています。USB ケーブルを使用して AM62L EVM をホストに接続すると、コンピュータは仮想 COM ポートを確立でき、任意の端末エミュレーション アプリケーションで使用できます。FT4232HL デバイスはバスから電源供給されているため、評価基板の電源が切り離されても COM ポートへの接続が失われることはありません。

表 2-24. UART ポート インターフェイス

UART ポート	USB-to-UART ブリッジ	USB コネクタ	COM ポート
SoC_UART0	FT4232HL	J7	COM1
SoC_UART1			COM2
WKUP_UART0			COM3
SoC_UART4			COM4

FT4232 チップは、接続された外部 SPI EEPROM からの構成ファイルを使用して、「シングルチップ USB から 4 チャンネル UART」モードで動作するよう構成されています。EEPROM (93LC46B) は、1Mbit/s のクロックレートに対応しています。EEPROM は、FTDI の Web サイトから入手できる FT_PROG というユーティリティプログラムを使用して、USB 経由で回路内でプログラム可能です。FT_PROG は、1 つまたは複数の基板がコンピュータに接続されているときに、ユーザーが基板のシリアル番号を使用して接続されている COM ポートを識別できるように、基板のシリアル番号をプログラムするためにも使用されます。

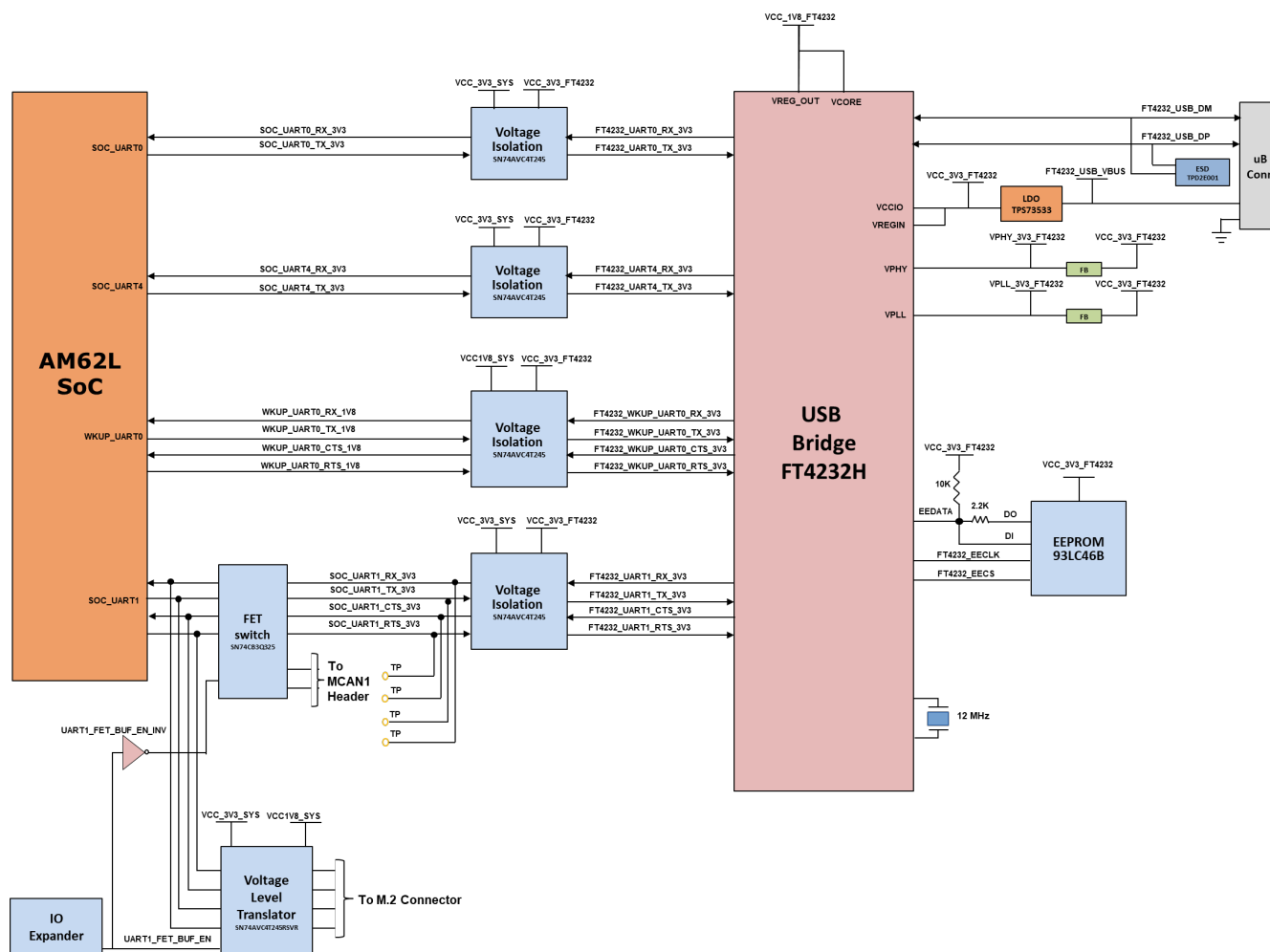


図 2-17. UART インターフェイスのブロック図

2.6.8 USB インターフェイス

2.6.8.1 USB 2.0 Type A インターフェイス

Type-A コネクタ J23 からの USB 2.0 データラインの DP および DM は、AM62L SoC の USB1 インターフェイスに接続されており、USB のハイスピード / フルスピード通信を実現しています。SoC への USB1_VBUS は、(5V~30V) の VBUS 動作に対応する抵抗分圧回路を介して供給されます。SoC の USB1_DRVVBUS は、500mA の電流制限付きロードスイッチ (メーカー型番 TPS2051BD) のイネーブルピンを制御し、オンボードの 5V 電源で VBUS に電力を供給できるようになっています。このロードスイッチには過電流表示ピンがあり、EVM 上の I2C ベースの GPIO エクスパンダに接続されています。

EMI/EMC 低減のために、USB データラインにコモン モード チョーク (メーカー型番 DLW21SZ900HQ2B) が配置されているほか、ESD ダイオード保護 (メーカー型番 ESD122DMXR) によって、過渡電圧を抑制します。また、ESD ダイオード (メーカー型番 TSD05DYFR) が VBUS_5V0_TYPEA に配置されています。

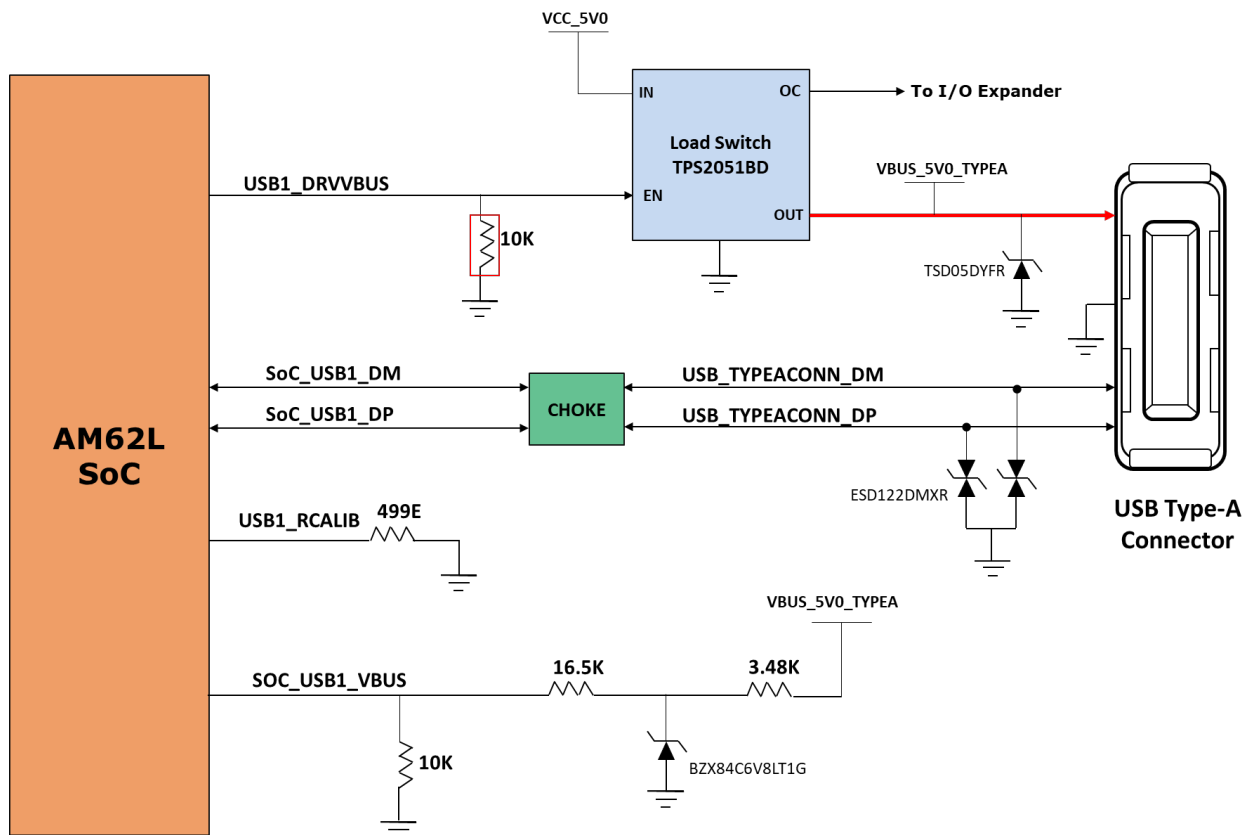


図 2-18. USB 2.0 Type-A インターフェイスのブロック図

2.6.8.2 USB 2.0 Type-C インターフェイス

AM62L EVM では、USB Type-C コネクタ J19 (メーカー型番 2012670005) によって USB 2.0 インターフェイスが提供され、最大 480Mbps のデータレートに対応しています。J19 はデータ通信や、EVM への電源コネクタとして使用することもできます。J19 は、PD コントローラ TPS65988DHRSHR IC を使用して、DRP ポートとして構成されています。そのため、ホストとしてもデバイスとしても機能します。ポートの役割は、コネクタに接続されるデバイスのタイプと、そのデバイスがシンクまたはソースのどちらであるかによって決まります。ポートが DFP として機能している場合、500mA で最大 5V を供給できます。

J19 からの USB 2.0 データラインの DP と DM には、チョークと ESD 保護デバイスがあります。SoC への USB0_VBUS は、(5V~30V) の VBUS 動作に対応する抵抗分圧回路を介して供給されます。

EMI/EMC 低減のため、USB データラインにコモン モード チョーク (メーカー型番 DLW21SZ900HQ2B) が配置されています。USB 2.0 DP/DM 信号の ESD 衝撃を放散させるため、ESD 保護デバイス (型番 ESD122DMXR) が搭載されています。CC 信号には ESD 保護デバイス (部品番号 TPD1E01B04DPLT) が搭載されており、ESD 衝撃を放散させるため、Type-C コネクタ J19 の VBUS レールには TVS2200DRVR IC が組み込まれています。

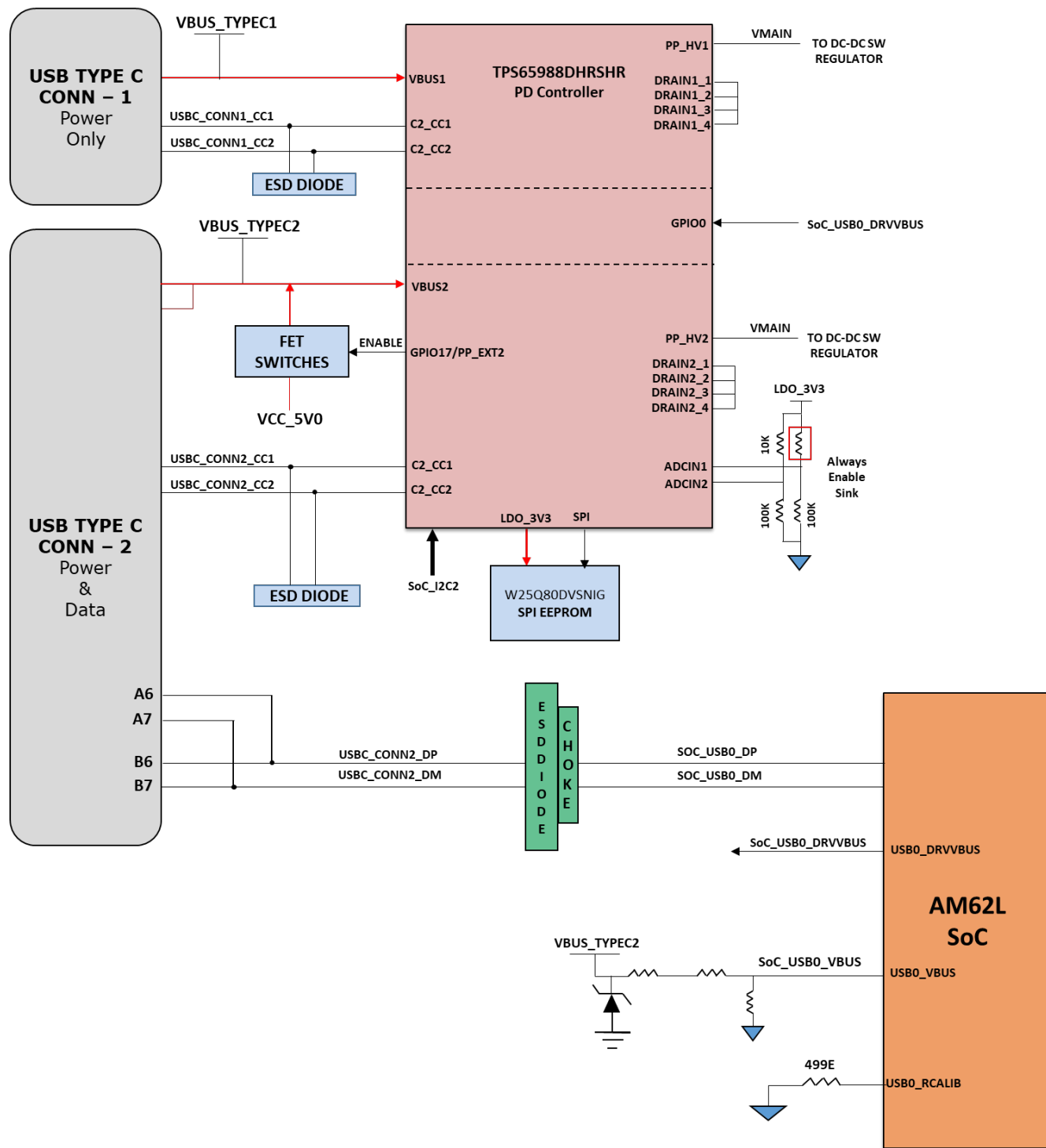


図 2-19. USB 2.0 Type-C インターフェイスのブロック図

2.6.9 MCAN インターフェイス

AM62L EVM には、3 つの MCAN インターフェイスが搭載されています。MAIN_MCAN0、MAIN_MCAN1、MAIN_MCAN2 は、それぞれ J16、J6、J18 という 3 つの 1x4 ヘッダに終端するものとします。ESD 保護のために、メーカー型番 TPD2E001DRLR が、MCAN0、MCAN1、MCAN2 の TX と RX に接続されています。3 つの MCAN ヘッダの最初のピンはすべて VCC_3V3_SYS に接続され、4 番目のピンは GND に接続されます。

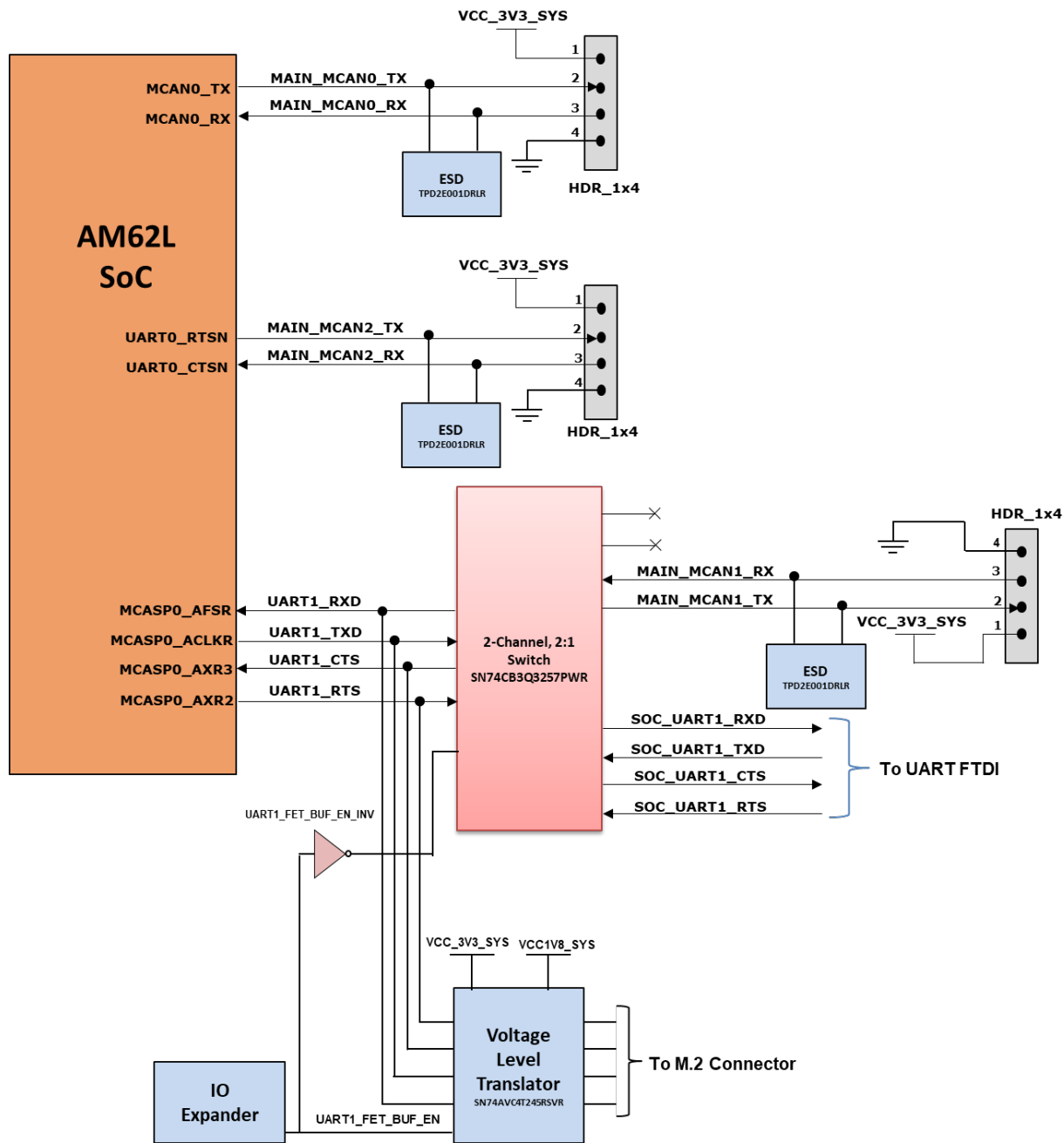


図 2-20. MCAN インターフェイスのブロック図

2.6.10 ADC インターフェイス

AM62L EVM には、2x5 ピン ヘッダ (J11) で終端された 4 つの ADC 入力があり、ポテンショメータはヘッダの A01 ピンに接続されています。ADC0_AIN[0:3] の信号には、ESD ダイオード (メーカー型番 TPD1E10B06DPYR) を用いて ESD 保護が行われています。

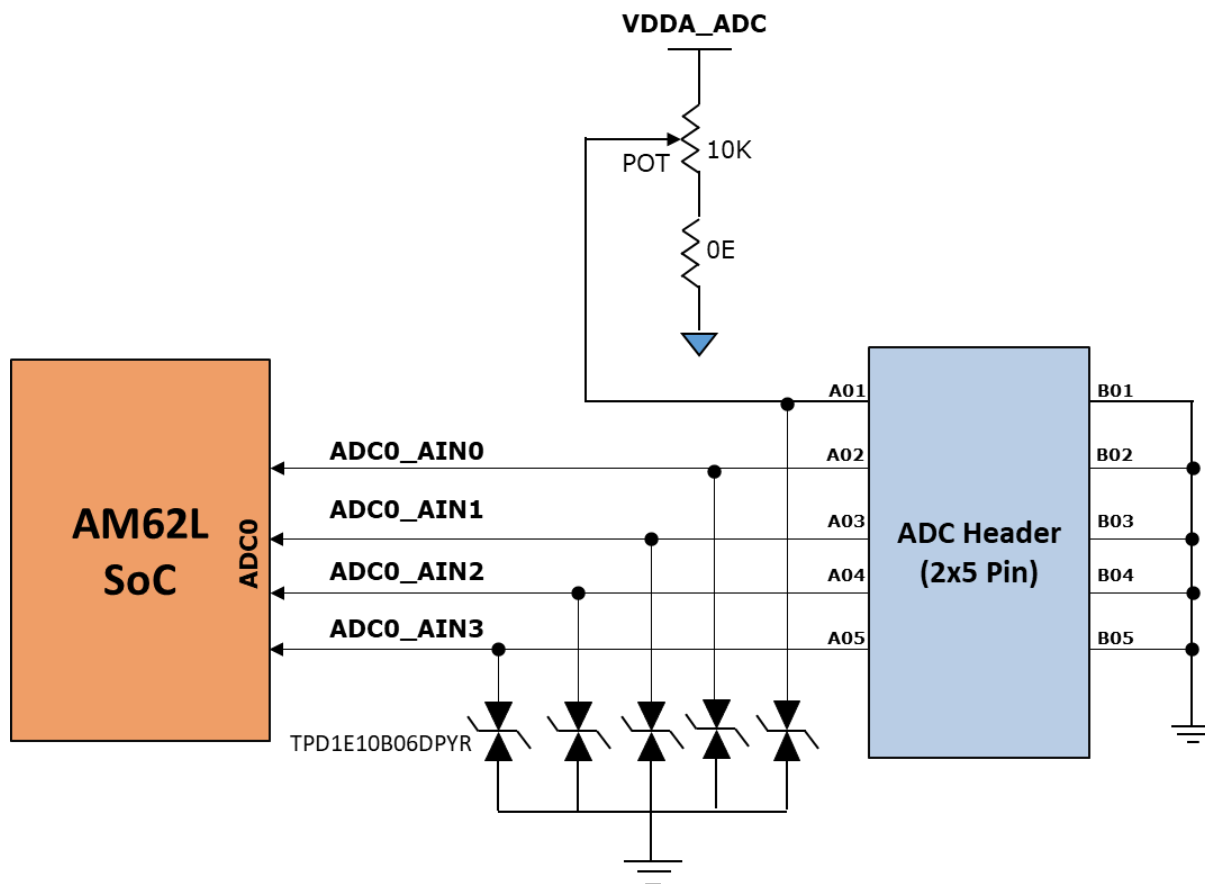


図 2-21. ADC インターフェイスのブロック図

2.6.11 メモリ インターフェイス

2.6.11.1 LPDDR4 インターフェイス

AM62L EVM には、最大 1600Mbps/s のデータレートをサポートする Micron のデュアルランク、デュアルダイ 2GB、16 ビット幅 LPDDR4 メモリ (MT53E1G16D1ZW-046 WT:C) が搭載されています。LPDDR4 メモリは最適な位置に配置され、SoC の DDR0 グループに接続されて、ポイントツー ポイント通信をサポートしています。

LPDDR4 メモリはコア電源に 1.8V が必要であるため、電力需要が抑えられます。I/O には、PMIC の 1.1V 電源出力から電力が供給されます。デフォルトのアクティブ状態を設定するため、AM62L SoC によって制御される LPDDR4 リセット (アクティブ Low) はプルダウンされています。また、プルアップ抵抗の実装も可能です。

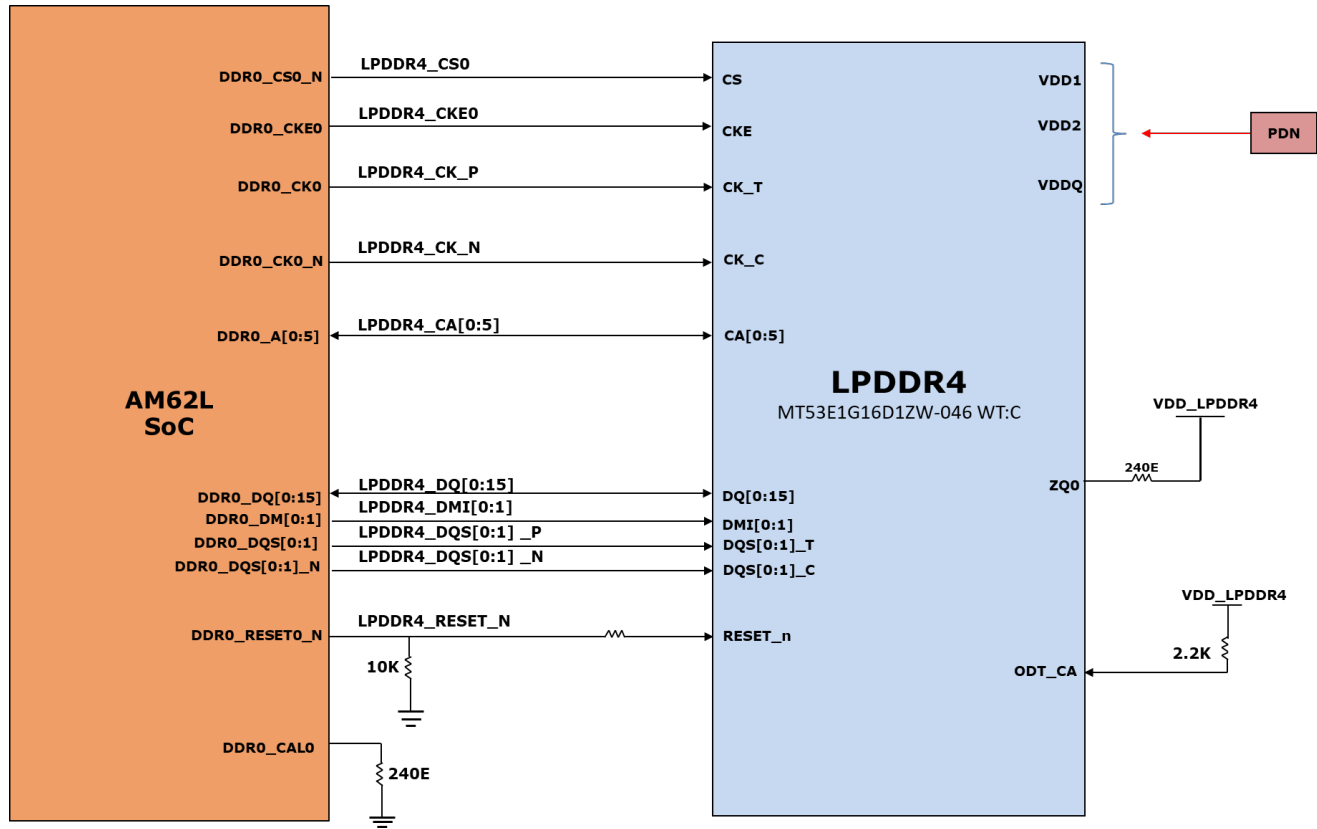


図 2-22. LPDDR4 インターフェイスのブロック図

AM62L SoC

OSPI Memory (NOR Flash) S28HS512GABHM010

QSPI Memory (NAND Flash) W25N01JWTBAG

Note: □ Indicates DNI

2.6.11.2.1 OSPI NOR フラッシュ

リセット:OSPI NOR フラッシュのリセットは、AM62L の RESETSTATz と SoC GPIO の GPIO_OSPI_NOR_RSTn 信号を論理積する回路に接続されています。デフォルトのアクティブ状態を設定するために、GPIO_OSPI_NOR_RSTn にはプルアップ抵抗が配置されています。

電源:OSPI NOR フラッシュメモリの VCC ピンと VCCQ ピンは両方とも、オンボードの 1.8V システム電源から供給されます。OSPI I/O グループは、SoC の VDDS1 ドメインから電力を供給され、このドメインは、同じ 1.8V システム電源から給電されています。

2.6.11.2.2 OSPI NAND フラッシュ

AM62L EVM ボードでは、1Gb QSPI NAND フラッシュ メモリ デバイス (Winbond、メーカー型番 W25N01JWTBAG) を、AM62L SoC の OSPI0 インターフェイスに接続しています。QSPI メモリは、最大 80MHz の DTR (デュアル転送レート) と、80MB/s の連続データ転送レートをサポートしています。QSPI NAND フラッシュは DATA[0:3] に接続されています。

リセット: QSPI NAND フラッシュのリセットは、AM62L の RESETSTATz と I/O エクスパンダの GPIO_QSPI_NAND_RSTn 信号を論理積する回路に接続されています。デフォルトのアクティブ状態を設定するために、GPIO_QSPI_NAND_RSTn にはプルアップ抵抗が配置されています。

電源: QSPI NAND フラッシュ メモリの VCC は、オンボードの 1.8V システム電源から供給されます。

2.6.11.3 MMC インターフェイス

AM62L SoC には、3 つの MMC ポート (MMC0、MMC1、MMC2) があります。MMC0 は eMMC に、MMC1 は microSD カード コネクタに接続され、MMC2 は Wi-Fi および BT モジュール インターフェイス用の M.2 Key E 拡張コネクタに終端されています。

2.6.11.3.1 MMC0 - eMMC インターフェイス

この評価基板には、AM62L SoC の MMC0 ポートに接続された 32GB eMMC フラッシュ メモリ (Micron、メーカー型番 MTFC32GBCAQTC-IT) が搭載されています。

フラッシュ メモリからのデータ バスは、最大 200MHz の HS200 シングル データ レートをサポートする MMC0 インターフェイスの 8 データ ビットに接続されています。Micron の eMMC は、マルチメディア カード (MMC) インターフェイスと NAND フラッシュ コンポーネントを搭載している通信および大容量データ ストレージ デバイスです。DAT[7:1] にはバスのフローティング状態を防ぐため、外付けプルアップ抵抗を取り付けるオプションがあり、CLK 信号には特性インピーダンスに合わせるため、SoC パッドの近くに直列抵抗が配置されています。

eMMC デバイスには、NAND メモリ用の 3.3V、eMMC インターフェイス用の 1.8V の 2 つの電源が必要です。SoC の MMC0 インターフェイス I/O は、固定 1.8V I/O 電源から供給される VDDSHV2 によって電力が供給されます。

eMMC デバイスには、ホストからのアクティブ Low リセットが必要です。ホストがこの機能を使用するには、ホストは ECSD レジスタ バイト 162、ビット[1:0] を 0x1 に設定して有効にする必要があります。外部リセットは、SoC の RESETSTATz と I/O エクスパンダの GPIO を論理積することによって生成されます。デフォルトのアクティブ状態を設定するため、GPIO ピンにプルアップが提供されています。

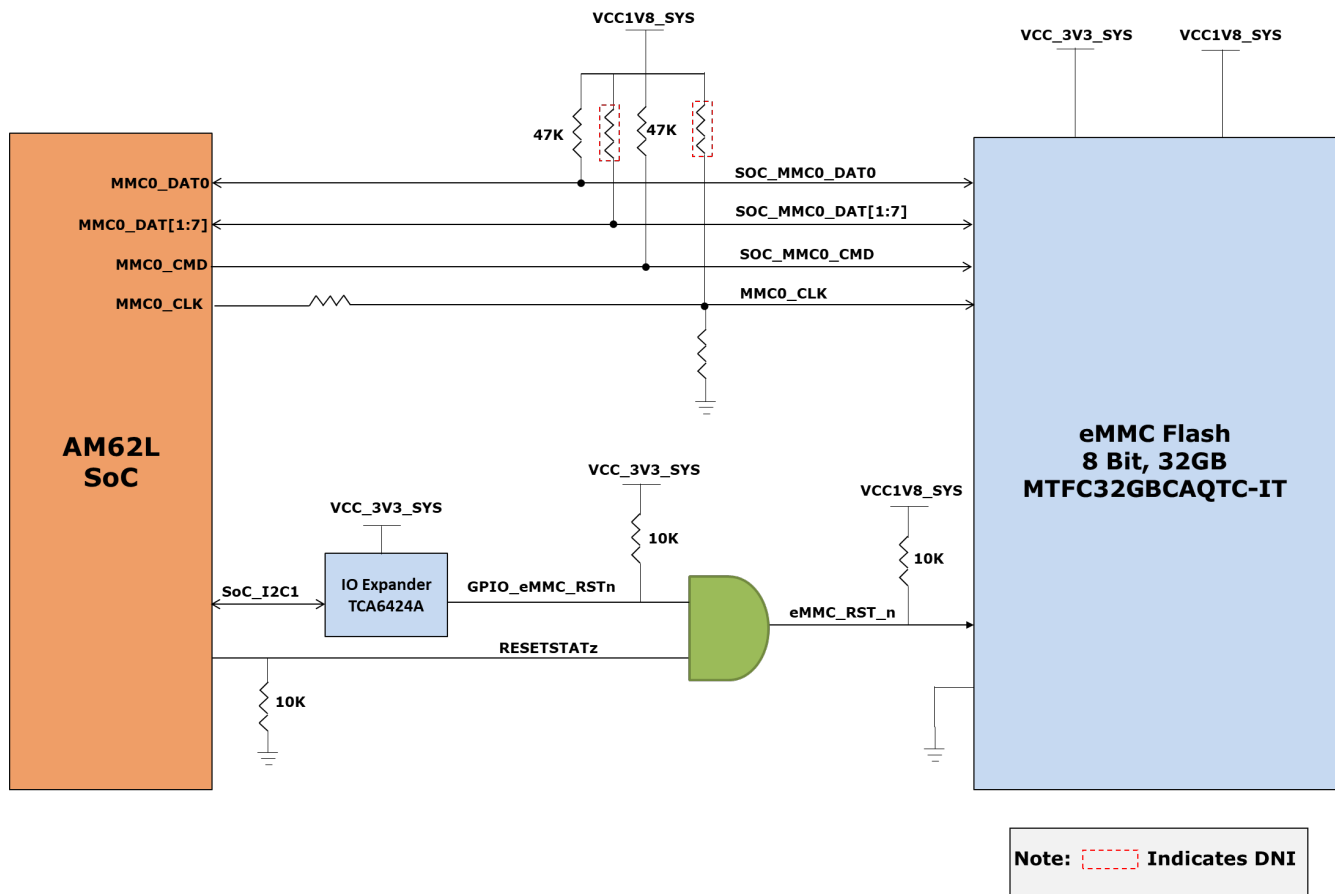


図 2-24. eMMC インターフェイスのブロック図

2.6.11.3.2 MMC1 - microSD インターフェイス

この EVM 基板では、microSD カードソケット (メーカー型番 MEM2051-00-195-00-A) が AM62L SoC の MMC1 ポートに接続されています。これにより、1.8V と 3.3V の両方での I/O 動作を含む UHS1 動作がサポートされます。microSD カード インターフェイスは、デフォルトで SD モードで動作するように設定されています。高速カードの場合、SoC の ROM コードはカードとコントローラがサポートできる最速の速度を検出しようと試み、その後で 1.8V への移行を試みます。SoC の MMC1 I/O は、VDDSHV_SD_IO から供給される VDDSHV3 によって電力が供給されます。VDDSHV_SD_IO は内部で生成され、SoC から供給されます。

microSD カードコネクタの電源は、ロードスイッチ (メーカー型番 TPS22918DBVR) を使用して供給され、RESETSTATz と I/O エクスパンダの GPIO 出力の論理積によって制御されます。

データ信号、クロック信号、コマンド信号用に、ESD 保護デバイス (部品番号 TPD6E001RSE) が搭載されています。TPD6E001RSE は TVS ダイオードを内蔵したライン終端デバイスで、IEC 61000-4-2 に準拠したシステムレベルの ESD 保護、±8kV の接触放電、±15kV のエアギャップ放電を提供します。

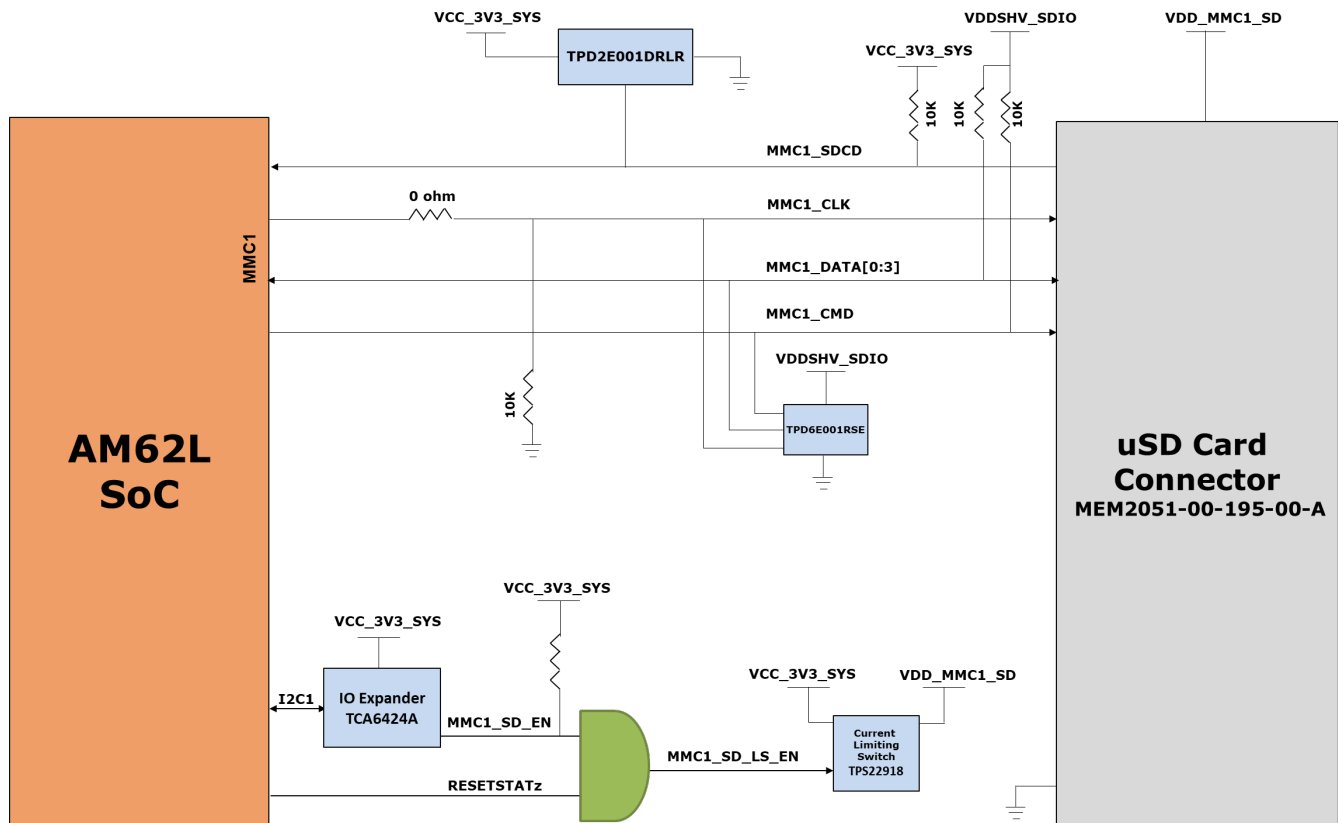


図 2-25. microSD インターフェイスのブロック図

2.6.11.3.3 MMC2 - M.2 Key E インターフェイス

AM62L EVM は、M.2 Key E 拡張機能を搭載しており、Wi-Fi/BT モジュールを、バッファ経由で MMC2、UART1、McASP0 の各インターフェイスに接続できます。これは、産業用温度グレードをサポートするアンテナを搭載した Wi-Fi、デュアルバンド、2.4GHz および 5GHz のモジュールとのインターフェイスとして使用できます。M.2 には、IEEE 規格 802.11a/b/g/n のデータをサポートする MMC2 インターフェイスの 4 ビット I/O が付属しています。M.2 コネクタは、高いスループットと到達範囲の延長ができるほか、Wi-Fi と Bluetooth の共存も実現できるモジュールとインターフェイスできるため、消費電力を最適化する設計に適しています。

M.2 コネクタには、インターフェイス モジュールの電源要件を満たすため、3.3V の電源がオンボード電源として供給されます。SoC の MMC2 インターフェイスは、1.8V I/O 電源に接続された VDDSHV4 電源ドメインから電力が供給されます。

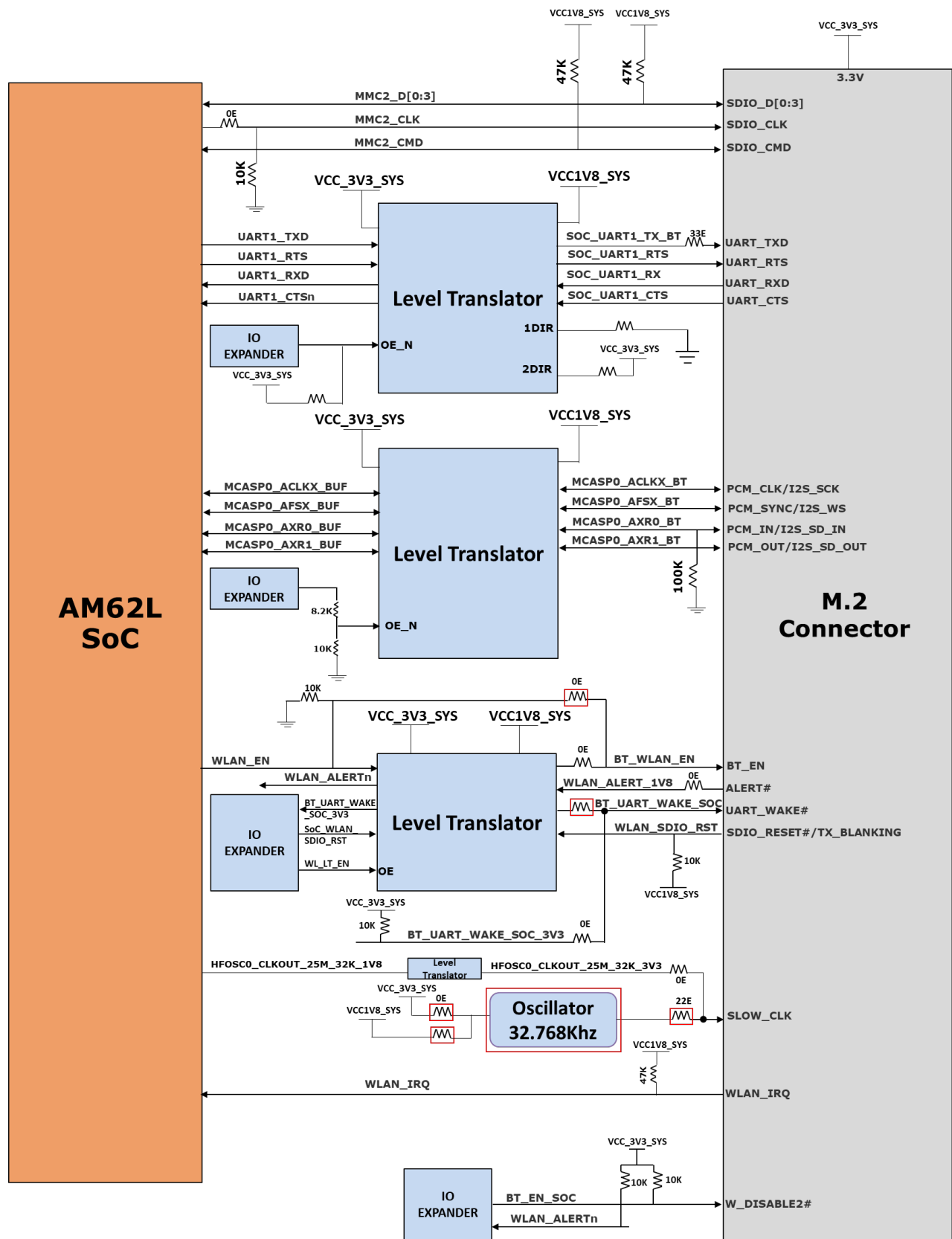


図 2-26. M.2 インターフェイスのブロック図

2.6.11.4 基板 ID EEPROM

AM62L EVM 基板は、オンボード EEPROM に保存されているバージョンとシリアル番号のデータからリモートで識別可能です。

Microchip の基板 ID メモリ AT24C512C-MAHM-T は、SoC の I2C0 ポートに接続されており、ヘッダー記述でプログラムされたアドレス 0x51 に応答するように構成されています。EEPROM の I2C アドレスは、A0 ピンを High に駆動し、A1 ピン、A2 ピンを Low に駆動することで変更できます。メモリの最初の 259 バイトは、各基板の識別情報であらかじめプログラムされています。残りの 65277 バイトは、データまたはコードの保存用にユーザーが使用できます。

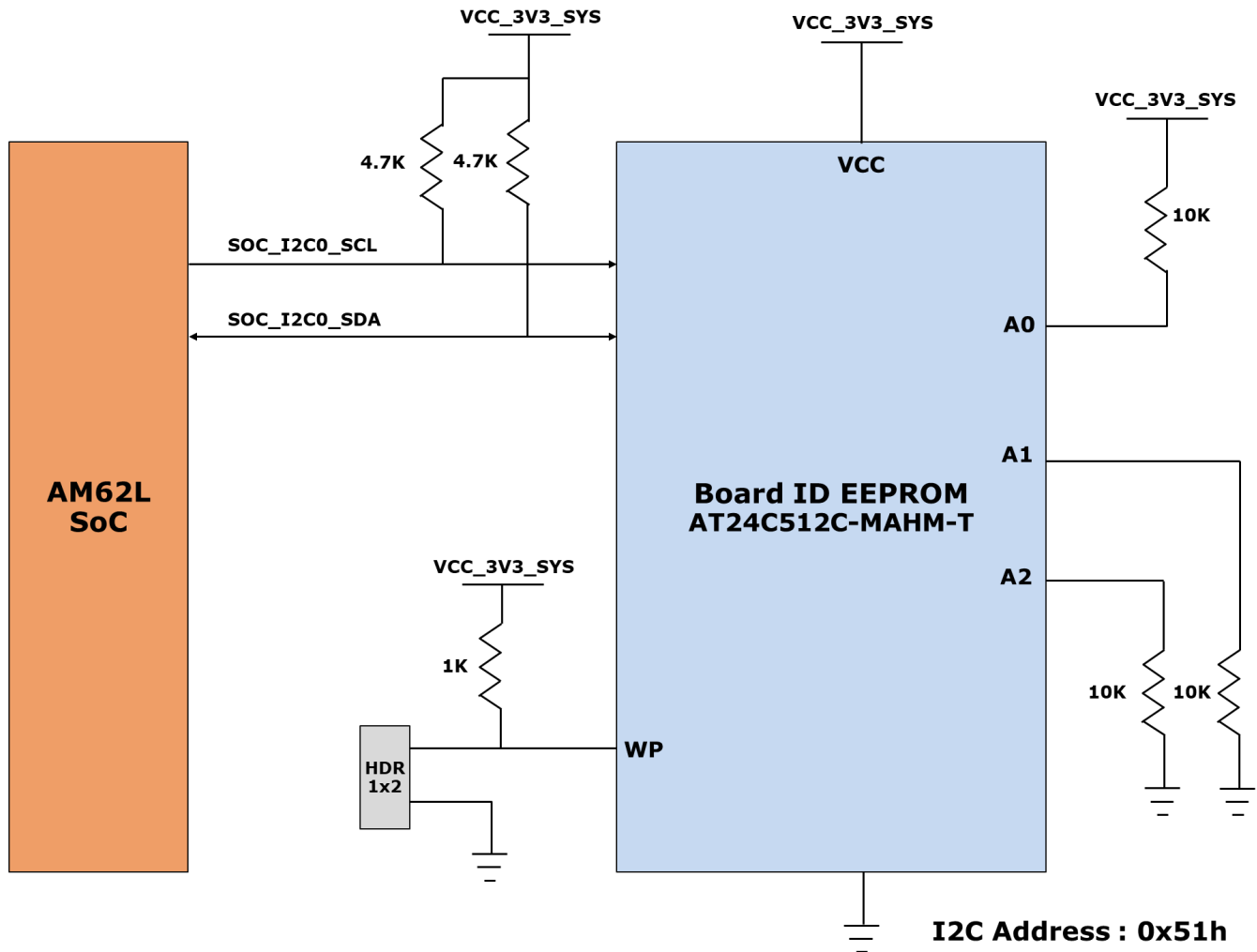


図 2-27. 基板 ID EEPROM インターフェイスのブロック図

2.6.12 イーサネット インターフェイス

AM62L EVM には、外部通信向けに、1 ギガビット速度のイーサネット ポートが 2 つあります。AM62L SoC の RGMII ギガビット イーサネット CPSW ポートの 2 つのチャネルは、個別のギガビット イーサネット PHY トランシーバ DP83867 に接続されています。これらのトランシーバは、内蔵された磁気部品を使用して 2 つの RJ45 コネクタで最終的に終端されます。

PHY DP83867 の 48 ピン バージョンは、設定された Tx および Rx クロック スキューで 1Gb 動作をアドバタイズして、AM62L 内部の内部遅延に対応するように構成されています。CPSW_RGMII1 ポートおよび CPSW_RGMII2 ポートは、外部 PHY トランシーバと通信するために、共通の MDIO バスを使用しています。

イーサネット 10/100/1000Mbps 接続には、ボード上で Link-PP の 2 つのシングル ポート RJ45 コネクタ (メーカー型番 LPJG16314A4NL) が使用されます。RJ45 コネクタには、1000BASE-T リンクと送受信アクティビティを示すための磁気素子および LED が内蔵されています。

イーサネット PHY への I/O 電源は 1.8V の I/O レベルに設定されています。

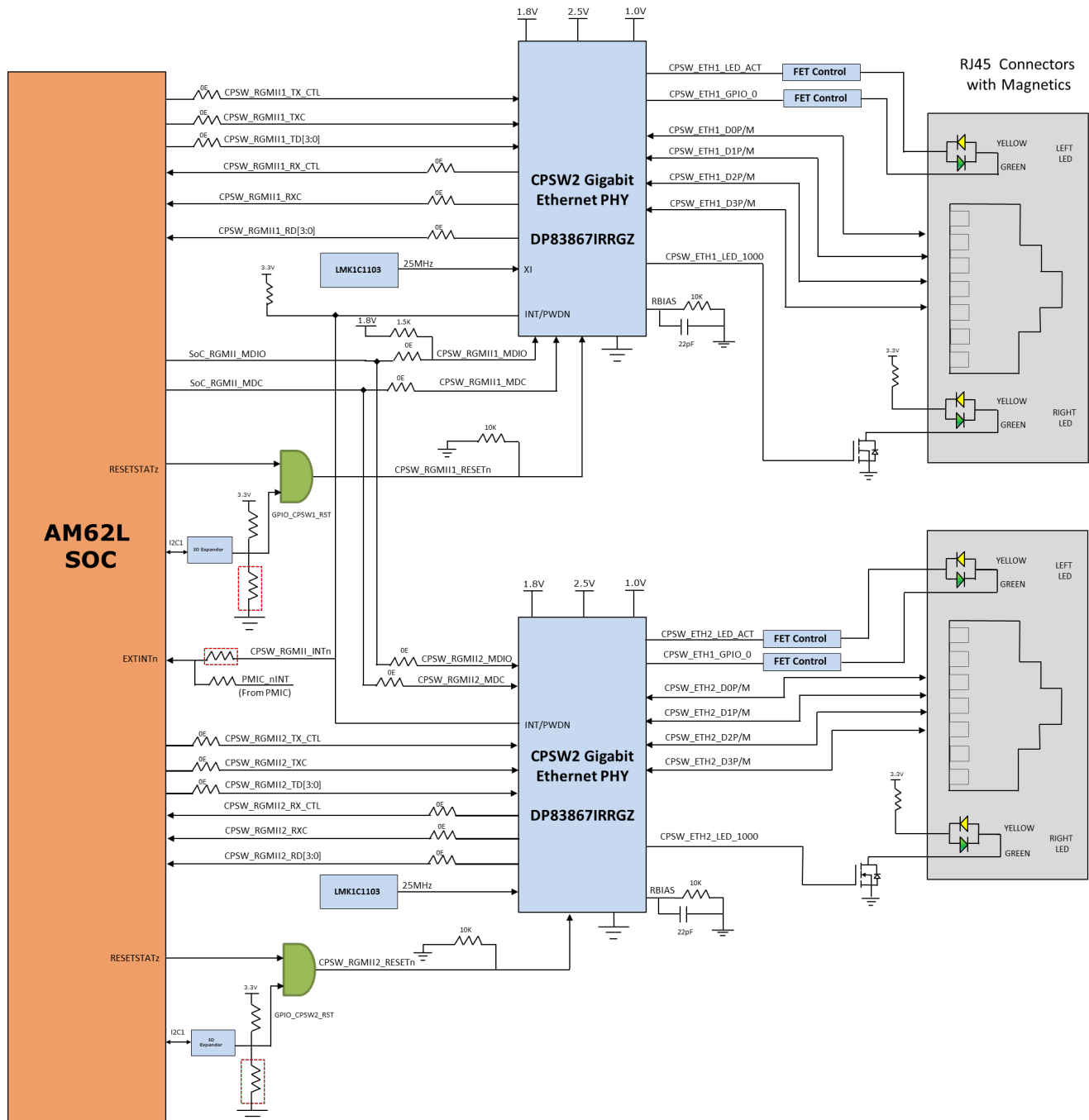


図 2-28. イーサネット インターフェイスのブロック図

2.6.12.1 CPSW イーサネット PHY ストラッピング

DP83867 のデフォルト構成は、PHY の特定のピンにある複数の抵抗プルアップおよびプルダウン値を使用して決定されています。インストールされている値に応じて、各構成ピンを次の 4 つのモードのいずれかに設定できます。AM62L EVM は、RGMII インターフェイスをサポートする 48 ピン QFN パッケージを使用しています。

DP83867 PHY は、抵抗ストラッピングに基づいて 4 つのレベル構成を使用して、4 つの異なる電圧範囲を生成します。これらの抵抗は、通常 PHY によって駆動されてプロセッサへの入力となる、RX データおよび制御ピンに接続されます。各モードの電圧範囲を以下に示します。

- モード 1 - 0V ~ 0.1764V
- モード 2 - 0.252V ~ 0.3438V
- モード 3 - 0.405V ~ 0.5112V
- モード 4 - 1.2492V ~ 1.5984V

LED_0 を除くすべてのストラッピング ピンに、プルアップとプルダウンの両方のフットプリントがあります。LED_0 はミラーイネーブル用であり、デフォルトでモード 1 に設定されています。モード 4 は適用できず、モード 2、モード 3 のオプションは不要です。

表 2-25. CPSW イーサネット PHY1 のデフォルト構成

PHY アドレス	00000
Auto_neg	イネーブル
ANG_SEL	10/100/1000
RGMII TXCLK スキュー:	0ns
RGMII RXCLK スキュー	2ns

表 2-26. CPSW イーサネット PHY2 のデフォルト構成

PHY アドレス	00001
Auto_neg	イネーブル
ANG_SEL	10/100/1000
RGMII TXCLK スキュー:	0ns
RGMII RXCLK スキュー	2ns

2.6.13 GPIO ポート エクスパンダ

AM62L EVM が使用している I/O エクスパンダは、24 ビットの I2C ベース I/O エクスパンダであり、ドーターカードのプラグイン検出や、オンボードで接続されている各種ペリフェラル デバイスに対するリセット信号やイネーブル信号の生成に使用できます。AM62L SoC の SoC_I2C1 バスは、I/O エクスパンダとインターフェイスするために使用されます。I/O エクスパンダの I2C デバイス アドレスは 0x22 および 0x23 です。

エクスパンダによって制御される信号のリストについては、表 2-27 を参照してください。

表 2-27. I/O エクスパンダの信号詳細

I/O エクスパンダ - 01			
ピン番号	信号	方向	目的
P02	UART1_FET_SEL	出力	UART1 FET の選択
P03	MMC1_SD_EN	出力	SD カード ロード スイッチの有効化
P04	VPP_LDO_EN	出力	SoC eFuse 電圧 (VPP = 1.8V) レギュレータのイネーブル
P05	EXP_PS_3V3_EN	出力	EXP CONN 3.3V パワー スイッチのイネーブル
P06	UART1_FET_BUF_EN	出力	SoC UART1 マルチプレクサの選択
P10	DSI_GPIO0	BIDIRECTIONAL	DSI ディスプレイ GPIO0
P11	DSI_GPIO1	BIDIRECTIONAL	DSI ディスプレイ GPIO1
P13	BT_UART_WAKE_SOC_3V3	入力	BT UART WKUP 信号
P14	USB_TYPEA_OC_INDICATION	入力	USB Type A 過電流インジケータ
P17	WLAN_ALERTn	入力	M.2 モジュール WLAN アラート入力
P20	HDMI_INTn	入力	HDMI 割り込み
P21	TEST_GPIO2	BIDIRECTIONAL	テスト オートメーション コネクタからの GPIO2 のテスト

表 2-27. I/O エクスパンダの信号詳細 (続き)

I/O エクスパンダ - 01			
ピン番号	信号	方向	目的
P22	MCASP0_FET_EN	出力	MCASP0 イネーブルおよび方向制御
P23	MCASP0_BUF_BT_EN	出力	
P24	MCASP0_FET_SEL	出力	
P25	DSI_EDID	入力	DSI から HDMI カードへのデバイス ID 割り込み
P26	PD_I2C_IRQ	入力	PD コントローラからの割り込み要求
P27	IO_EXP_TEST_LED	出力	ユーザー テスト LED 2
I/O エクスパンダ - 02			
ピン番号	信号	方向	デバイス
P00	BT_EN_SOC	出力	M.2 モジュールの Bluetooth LDO のイネーブル
P01	VOUT0_FET_SEL0	出力	VOUT0 FET スイッチの選択
P10	WL_LT_EN	出力	M.2 インターフェイス レベルトランスレータのイネーブル
P11	EXP_PS_5V0_EN	出力	EXP CONN 5V パワー スイッチのイネーブル
P20	GPIO_QSPI_NAND_RSTn	出力	QSPI NAND フラッシュ リセット制御 GPIO
P21	GPIO_HDMI_RSTn	出力	HDMI トランスミッタ リセット制御 GPIO
P22	GPIO_CPSW1_RST	出力	CPSW イーサネット PHY-1 リセット制御 GPIO
P23	GPIO_CPSW2_RST	出力	CPSW イーサネット PHY-2 リセット制御 GPIO
P24	GPIO_BOOTMODE_BUF_ENz	出力	ブートモード バッファのイネーブル
P25	GPIO_AUD_RSTn	出力	オーディオ コーデック リセット制御 GPIO
P26	GPIO_eMMC_RSTn	出力	eMMC リセット制御 GPIO
P27	SOC_WLAN_SDIO_RST	出力	M.2 モジュール WLAN/SDIO のリセット

2.6.14 GPIO へのマッピング

表 2-28 に、AM62L EVM ペリフェラルを搭載した AM62L ローパワー SoC の GPIO へのマッピングの詳細を示します。

表 2-28. AM62L ローパワー SK EVM ペリフェラルを搭載した AM62D ローパワー SoC のマッピング

シリアル番号	GPIO 名称	GPIO ネット名	機能	使用 GPIO	パッケージ信号名	制御の方向	デフォルト状態	アクティブ状態	SoC 側の電圧ドメイン	SKEVM に接続されている電圧レール
1	WLAN インターフェイスのイネーブル	WLAN/EN	イネーブル	GPIO0_51	MMC2_SDCD	出力	Low	High	VDDSHV4	SoC_DVDD1V8
2	WLAN 割り込み	WLAN_IRQ	割り込み	GPIO0_52	MMC2_SDWP	入力	High	Low	VDDSHV4	SoC_DVDD1V8
3	OSPI NOR リセット制御 GPIO	GPIO_OSPI_NO_RSTn	リセット	GPIO0_12	OSPI0_CSn1	出力	High	Low	VDDSD1	SoC_DVDD1V8
4	OSPI NOR 割り込み	OSPI_NOR_INTn	割り込み	GPIO0_13	OSPI0_CSn2	入力	High	Low	VDDSD1	SoC_DVDD1V8
8	CPSW イーサネット PHY 割り込み	CPSW_RGMII_INTn	割り込み	GPIO0_105	EXTINTn	入力	High	Low	VDDSHV1	SoC_DVDD3V3
5	IO エクスパンダ割り込み	GPIO0_91_INTn	割り込み	GPIO0_91	SPI0_D1	入力	High	Low	VDDSHV1	SoC_DVDD3V3
6	ユーザー テスト LED 制御信号	SOC_GPIO0_123	イネーブル	GPIO0_123	MMC1_SDWP	出力	Low	High	VDDSHV1	SoC_DVDD3V3
7	ユーザー割り込み	GPIO0_90_INTn	割り込み	GPIO0_90	SPI0_D0	入力	High	Low	VDDSHV1	SoC_DVDD3V3
8	PMIC 割り込み	PMIC_nINT	割り込み	GPIO0_105	EXTINTn	入力	High	Low	VDDSHV1	SoC_DVDD3V3
9	VOUT0 FET スイッチの選択	SoC_VOUT0_FET_SEL1	選択	GPIO0_87	SPI0_CS0	出力	High	該当なし	VDDSHV1	SoC_DVDD3V3
10	VOUT0 FET スイッチの選択	SoC_VOUT0_FET_SEL0	選択	GPIO0_89	SPI0_CLK	出力	High	該当なし	VDDSHV1	SoC_DVDD3V3
I/O エクスパンダ - 01										
1	UART1 FET 選択制御	UART1_FET_SEL	方向制御	I/O エクスパンダ-P02		出力	High	該当なし		VCC_3V3_SYS
2	SD カード ロード スイッチの有効化	MMC1_SD_EN	イネーブル	I/O エクスパンダ-P03		出力	High	High		VCC_3V3_SYS

表 2-28. AM62L ローパワー SK EVM ペリフェラルを搭載した AM62L ローパワー SoC のマッピング (続き)

シリアル番号	GPIO 名称	GPIO ネット名	機能	使用 GPIO	パッケージ信号名	制御の方向	デフォルト状態	アクティブ状態	SoC 側の電圧ドメイン	SKEVM に接続されている電圧レール
3	SoC eFuse 電圧 (VPP = 1.8V) レギュレータのイネーブル	VPP_LDO_EN	イネーブル	I/O エクスパンダ-P04		出力	Low	High		VCC_3V3_SYS
4	EXP CONN 3.3V パワー スイッチのイネーブル	EXP_PS_3V3_EN	イネーブル	I/O エクスパンダ-P05		出力	Low	High		VCC_3V3_SYS
5	SoC UART1 マルチプレクサのイネーブル	UART1_FET_BUF_EN	イネーブル	I/O エクスパンダ-P06		出力	High	Low		VCC_3V3_SYS
6	DSI ディスプレイ GPIO0	DSI_GPIO0	GPIO	I/O エクスパンダ-P10		BIDIRECTIONAL	該当なし	該当なし		VCC_3V3_SYS
7	DSI ディスプレイ GPIO1	DSI_GPIO1	GPIO	I/O エクスパンダ-P11		BIDIRECTIONAL	該当なし	該当なし		VCC_3V3_SYS
8	BT UART WKUP 信号	BT_UART_WAKE_SOC_3V3	割り込み	I/O エクスパンダ-P13		入力	High	Low		VCC_3V3_SYS
9	USB Type A 過電流インジケータ	USB_TYPEA_OC_INDICATION	割り込み	I/O エクスパンダ-P14		入力	High	Low		VCC_3V3_SYS
10	WLAN アラート割り込み	WLAN_ALERTn	割り込み	I/O エクスパンダ-P17		入力	High	Low		VCC_3V3_SYS
11	HDMI 割り込み	HDMI_INTn	割り込み	I/O エクスパンダ-P20		入力	High	Low		VCC_3V3_SYS
12	TEST GPIO2	TEST_GPIO2	GPIO	I/O エクスパンダ-P21		該当なし	High	該当なし		VCC_3V3_SYS
13		MCASP0_FET_EN	イネーブル	I/O エクスパンダ-P22		出力	Low	Low		VCC_3V3_SYS
14	MCASP0 イネーブルおよび方向制御	MCASP0_BUF_BT_EN	イネーブル	I/O エクスパンダ-P23		出力	Low	High		VCC_3V3_SYS
15		MCASP0_FET_SEL	方向制御	I/O エクスパンダ-P24		出力	High	該当なし		VCC_3V3_SYS
16	DSI から HDMI カードへのデバイス ID 割り込み	DSI_EDID	割り込み	I/O エクスパンダ-P25		入力	High	Low		VCC_3V3_SYS
17	パワー デリバリ I2C 割り込み要求	PD_I2C_IRQ	割り込み	I/O エクスパンダ-P26		入力	High	Low		VCC_3V3_SYS
18	ユーザー テスト LED 2	IO_EXP_TEST_LED	GPIO	I/O エクスパンダ-P27		出力	Low	High		VCC_3V3_SYS
I/O エクスパンダ - 02										
1	M.2 モジュールの Bluetooth LDO のイネーブル	BT_EN_SOC	イネーブル	I/O エクスパンダ-P00		出力	High	High		VCC_3V3_SYS
2	VOUT0 FET スイッチの選択	VOUT0_FET_SEL0	選択	I/O エクスパンダ-P01		出力	Low	該当なし		VCC_3V3_SYS
3	M.2 インターフェイス レベルトランスレータのイネーブル	WL_LT_EN	イネーブル	I/O エクスパンダ-P10		出力	High	High		VCC_3V3_SYS
4	EXP CONN 5V パワー スイッチのイネーブル	EXP_PS_5V0_EN	イネーブル	I/O エクスパンダ-P11		出力	Low	High		VCC_3V3_SYS
5	QSPI NAND リセット制御 GPIO	GPIO_QSPI_NAND_RSTn	リセット	I/O エクスパンダ-P20		出力	High	Low		VCC_3V3_SYS
6	HDMI トランスミッタ リセット制御 GPIO	GPIO_HDMI_RSTn	リセット	I/O エクスパンダ-P21		出力	High	Low		VCC_3V3_SYS
7	CPSW イーサネット PHY-1 リセット制御 GPIO	GPIO_CPSW1_RST	リセット	I/O エクスパンダ-P22		出力	High	Low		VCC_3V3_SYS
8	CPSW イーサネット PHY-2 リセット制御 GPIO	GPIO_CPSW2_RST	リセット	I/O エクスパンダ-P23		出力	High	Low		VCC_3V3_SYS
9	ブートモード バッファのイネーブル	GPIO_BOOTMODE_BUF_ENz	イネーブル	I/O エクスパンダ-P24		出力	High	Low		VCC_3V3_SYS
10	オーディオ コーデック リセット制御 GPIO	GPIO_AUD_RSTn	リセット	I/O エクスパンダ-P25		出力	High	Low		VCC_3V3_SYS
11	eMMC リセット制御 GPIO	GPIO_EMMC_RSTn	リセット	I/O エクスパンダ-P26		出力	High	Low		VCC_3V3_SYS
12	WLAN リセット制御 GPIO	SOC_WLAN_SDIO_RST	リセット	I/O エクスパンダ-P27		出力	High	Low		VCC_3V3_SYS

2.7 電源

2.7.1 電源入力

Type-C コネクタ (VBUS ラインと CC ライン) はどちらも、デュアル PD コントローラ (メーカー型番 TPS65988) に接続されています。TPS65988 は、スタンドアロンの USB Type-C およびパワー デリバリティ (PD) コントローラであり、2 つの USB Type-C コネクタのケーブルのプラグと向きを検出します。ケーブルを検出すると、TPS65988 は USB PD プロトコルを使用して CC ワイヤで通信を行います。ケーブルの検出と USB PD ネゴシエーションが完了すると、TPS65988 は適切な電力パスを有効にします。TPS65988 の 2 つの内部電力パスは、2 つの Type-C ポートのシンクパスとして構成され、DFP として動作する場合には Type-C CONN 2 から 5V を供給するための外部 FET パスが提供されています。外部 FET パスは、PD コントローラの GPIO17/PP_EXT2 によって制御され、AM62L SoC の USB0 DRVVBUS の使用も可能にする抵抗オプションも備えています。

TPS65988 PD コントローラは、CC ネゴシエーションにより、3A (最大 12V) の出力を供給できます。両方の Type-C コネクタからの VBUS ピンは、PD コントローラの VBUS ピンに接続されています。PD の出力は VMAIN です。この VMAIN は、オンボードの昇降圧レギュレータと降圧レギュレータに供給され、評価基板用の 5V と 3.3V の固定電源を生成します。

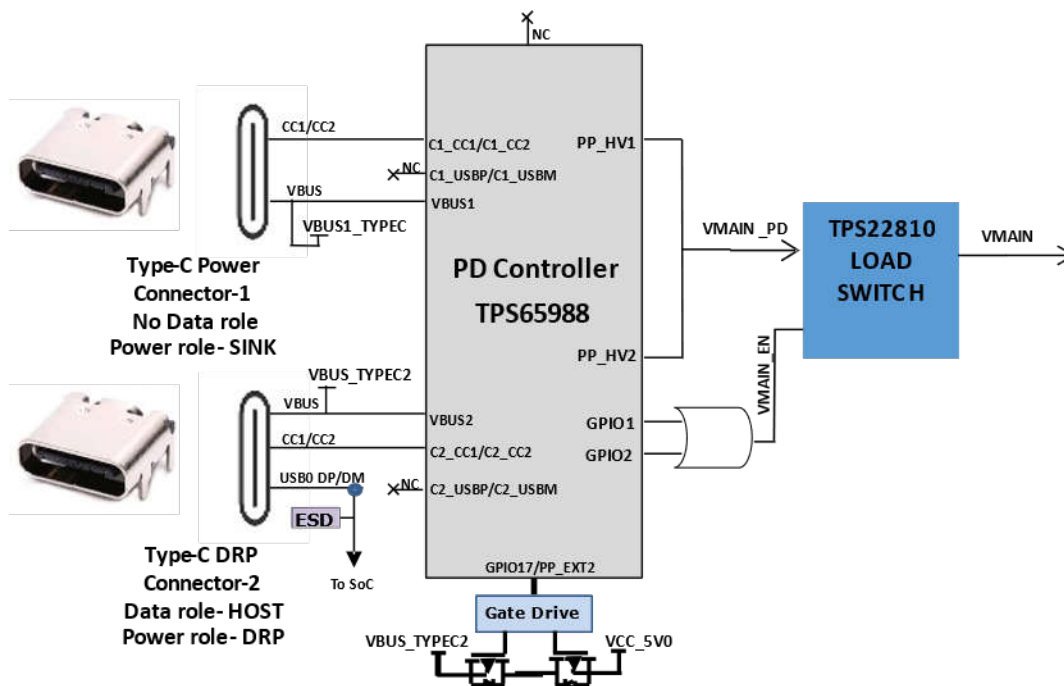


図 2-29. 電源入力のブロック図

2.7.2 電源

AM62L EVM は、DC/DC コンバータのアレイを使用して、ボード上のさまざまなメモリ、クロック、SoC、その他のコンポーネントに必要な電圧と電力を供給します。

図 2-30 に、AM62L EVM 基板上の各ペリフェラルに対し電源レールを供給するために使用される、各種のディスクリートレギュレータ、PMIC、LDO を示します。

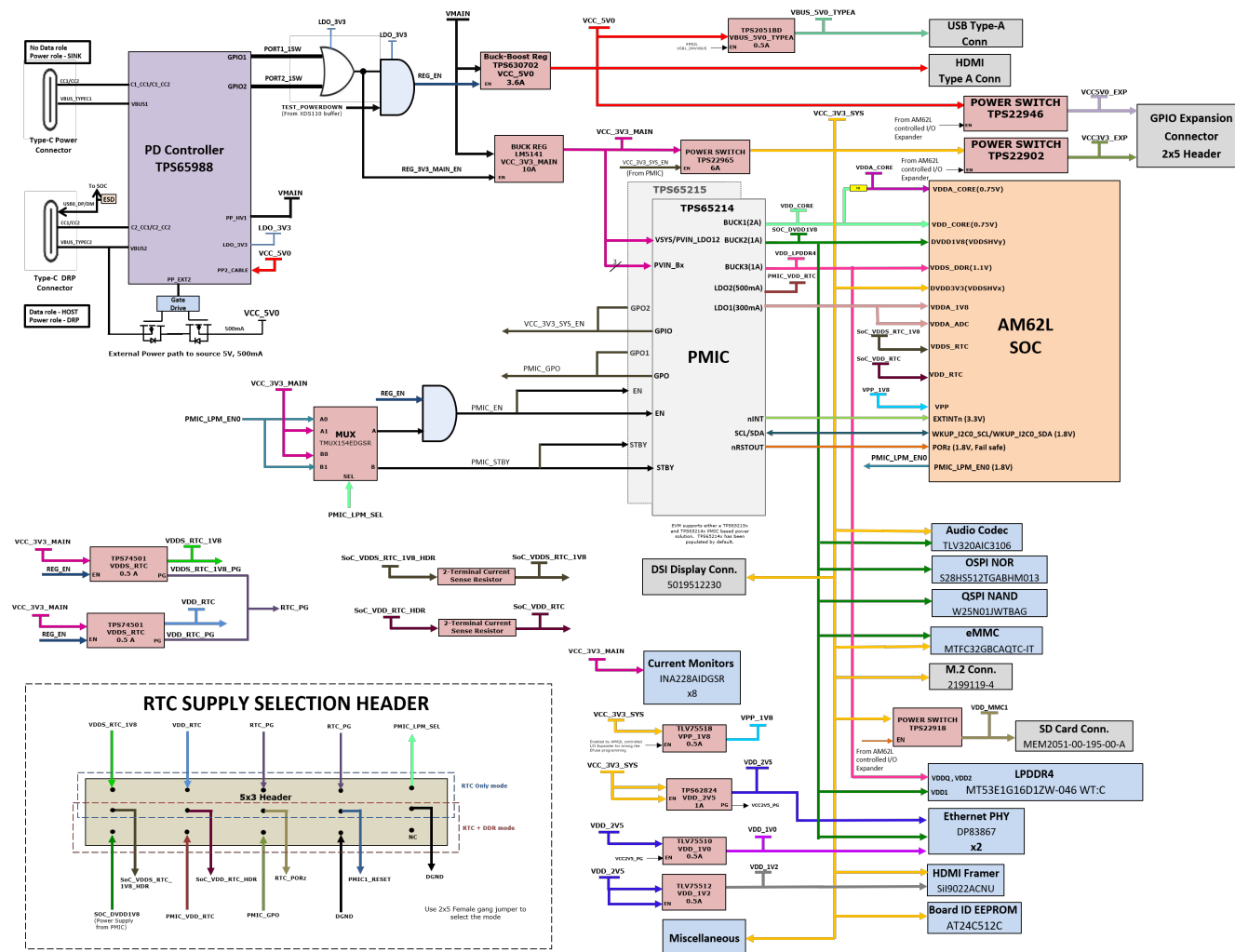


図 2-30. 電力アーキテクチャ

以下のセクションでは、EVM ボード、サポートコンポーネント、リファレンス電圧に電力を供給する電源分配ネットワークのトポロジについて説明します。

注

低消費電力モードをサポートするために必要な接続の詳細については、『AM62L の電源実装』アプリケーションノート (AM62L の電源実装) を参照してください。

AM62L EVM 基板には、ディスクリート電源コンポーネントに基づく電源ソリューションが搭載されています。電源供給の初期段階は、2 つの USB Type-C コネクタ J17 と J19 のいずれかからの VBUS 電圧になります。システムに必要な電力のネゴシエーションには、USB Type-C デュアル PD コントローラ (メーカー型番 TPS65988DHRSHR) が使用されます。PD コントローラの GPIO1 と GPIO2 に提供されるネット名は、それぞれ PORT1_15W_EN および PORT2_15W_EN です。電力が 15W 以上の場合、これらのピンはネゴシエーションに使用されます。このロジックにより、5V および 3.3V 電源を生成できます。ロジックを、図 2-31 に示します。

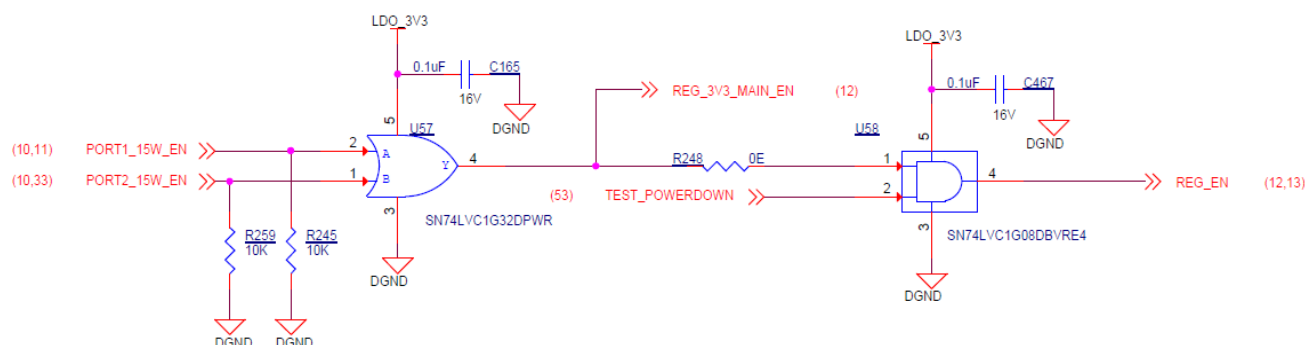


図 2-31. 5V および 3.3V 電源の生成を可能にするロジック

REG_3V3_MAIN_EN 信号は 3.3V 電源の生成をイネーブルし、REG_EN 信号は 5V 電源の生成をイネーブルします。昇降圧コントローラ TPS630702RNMR と降圧コンバータ LM5141RGET は、それぞれ 5V と 3.3V の生成に使用され、レギュレータへの入力 PD 出力です。これらの 3.3V と 5V は、AM62L EVM 基板の電源リソースの主要な電圧です。降圧レギュレータ LM5141RGET から生成された 3.3V 電源は、PMIC、各種 SoC レギュレータ、LDO への入力電源です。昇降圧レギュレータ TPS630702RNMR から生成された 5V 電源は、オンボードのペリフェラルの電源に使用されます。

基板上で使用されるディスクリートレギュレータと LDO は次のとおりです。

- TPS62824DMQR - イーサネット PHY 用に VDD_2V5 レールを生成
- TLV75510PDQNR - イーサネット PHY 用に VDD_1V0 を生成
- TLV75512PDQNR - HDMI フレーマ用に VDD_1V2 を生成
- PTPS6521401VAFR (PMIC - 2) - 各種 SoC およびペリフェラルの電源を生成
- TPS74501PDRVR LDO - VDDS_RTC_1V8 を生成
- TPS74501PDRVR LDO - VDD_RTC を生成
- TPS79601DRBR LDO - XDS110 オンボード エミュレータ
- TPS73533DRVR LDO - FT4232 UART-to-USB ブリッジ
- TLV75518PDBVR LDO - SoC の VPP e-Fuse プログラミング

2.7.3 電源シーケンス

図 2-32 に、AM62L SoC 電源のパワーアップおよびパワーダウンのシーケンスを示します。

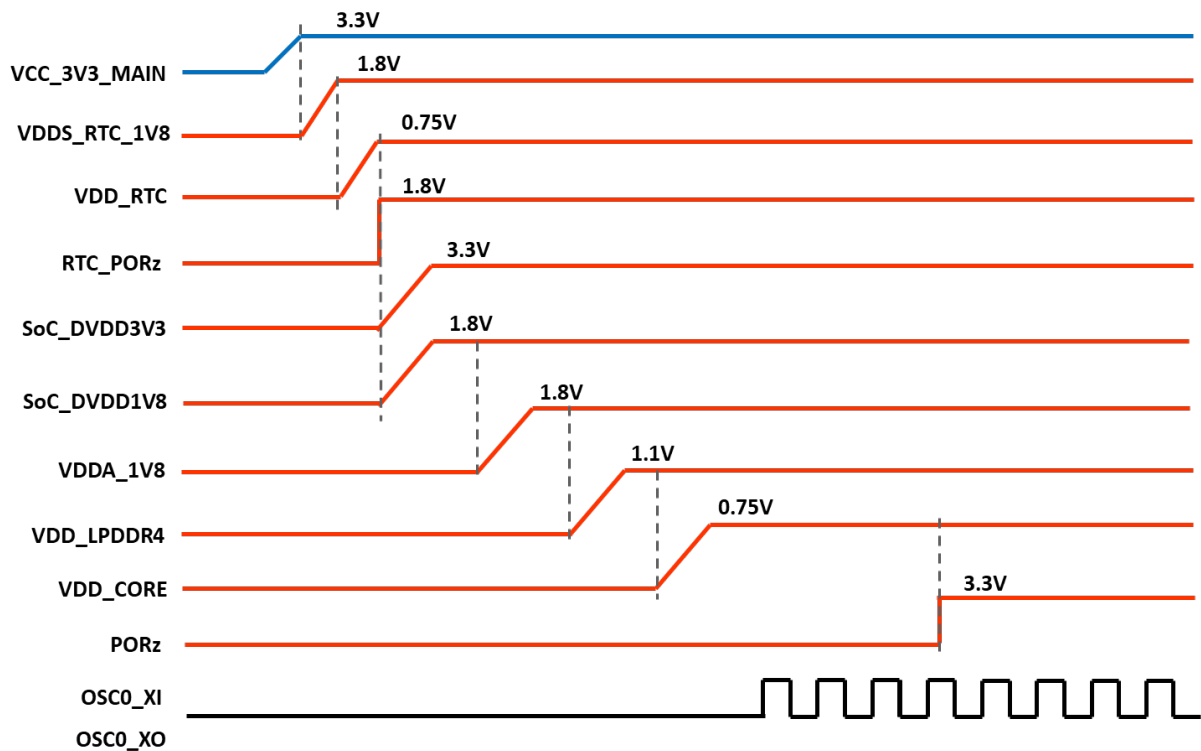


図 2-32. 電源シーケンス

2.7.4 AM62L SoC 電源

AM62L SoC のコア電圧は 0.75V です。電流モニタは、SoC 電源レールのすべてに搭載されています。

SoC には異なる I/O グループがあります。各 I/O グループには、表 2-29 に示すように、特定の電源から電力が供給されます。

表 2-29. SoC 電源

シリアル番号	電源	SoC 電源レール	I/O 電源グループ	電圧
1	VDD_CORE	VDDA_CORE	CORE	0.75
		VDDA_DDR_PLL0		
2	VDDA_CORE	VDDA_CORE_USB	USB	0.75
		VDDA_CORE_DSI	DSI	
		VDDA_CORE_DSI_CLK		
3	SoC_VDD_RTC	VDD_RTC	RTC	0.75
4	SoC_VDDS_RTC_1V8	VDDS_RTC	RTC	1.8
5	VDDA_1V8	VDDA_1P8_DSI	DSI	1.8
		VDDA_ADC	ADC0	
		VDDS_OSC0	OSC0	
		VDDA_PLL[0:1]		
		VDDA_1P8_USB	USB	
6	VDD_LPDDR4	VDDS_DDR	DDR0	1.1
7	VPP_1V8	VPP_1V8		1.8
8	VDDSHV_SD_IO	VDDSHV3	MMC1	3.3/1.8

表 2-29. SoC 電源 (続き)

シリアル番号	電源	SoC 電源レール	I/O 電源グループ	電圧
9	SOC_DVDD1V8	VDDSHV2	MMC0	1.8
		VDDS_WKUP	WKUP	
		VDDSHV4	MMC2	
		VDDS0	GENERAL0	
		VDDS1	GENERAL0_1	
10	SOC_DVDD3V3	VDDSHV0	GPMC	3.3
		VDDSHV1	GENERAL1	
		VDDA_3P3_USB	USB	
11	VDD_MMC1_SD	VDDA_3P3_SDIO		3.3

2.7.5 電流監視

INA228 電流監視デバイスは、AM62L SoC の各種電源レールの電流と電圧を監視するために使用されます。INA228 は、I2C インターフェイス SoC_I2C1_SDA_INA および SoC_I2C1_SCL_INA (それぞれ SoC_I2C1_SCL および SoC_I2C1_SDA のレベルシフトバージョン) を介して AM62L SoC とインターフェイスします。TCA9517DR は I2C レベルシフタであり、SoC_I2C1 を VCC_3V3_SYS から VCC_3V3_MAIN にレベルシフトするために使用されます。2 端子の幅広シャント抵抗が付属した SoC_VDDS_RTC_1V8 および SoC_VDD_RTC 電源を除くすべての電源の負荷電流を測定するために、4 端子の高精度シャント抵抗が実装されています。

注

この設計は、INA228 または INA231 を使用する電流 / 電圧測定をサポートしています。INA228 は、この評価基板 (EVM) にのみ実装されています (スタック PCB フットプリントで実装)。

表 2-30. INA I2C デバイス アドレス

ソース	電源ネット	デバイス アドレス	電源レールに接続されているシャントの値
VCC_CORE	VDD_CORE	0x40	20mΩ ± 1%
VCC_3V3_SYS	SoC_DVDD3V3	0x4C	100mΩ ± 0.5%
VCC1V8_SYS	SoC_DVDD1V8	0x45	100mΩ ± 0.5%
VDDA1V8	VDDA_1V8	0x4D	100mΩ ± 0.5%
VCC1V1_PMIC1 (PMIC 1 より)	VDD_LPDDR4 (PMIC 1 より)	0x47	40mΩ ± 1%
VCC1V1_PMIC2 (PMIC 2 より)	VDD_LPDDR4 (PMIC 2 より)	0x49	40mΩ ± 1%
SoC_VDD_RTC_HDR	SoC_VDD_RTC	0x44	1Ω ± 0.5%
SoC_VDDS_RTC_1V8_HDR	SoC_VDDS_RTC_1V8	0x46	1Ω ± 0.5%

2.8 クロック処理

AM62L EVM のクロック アーキテクチャを、図 2-33 に示します。

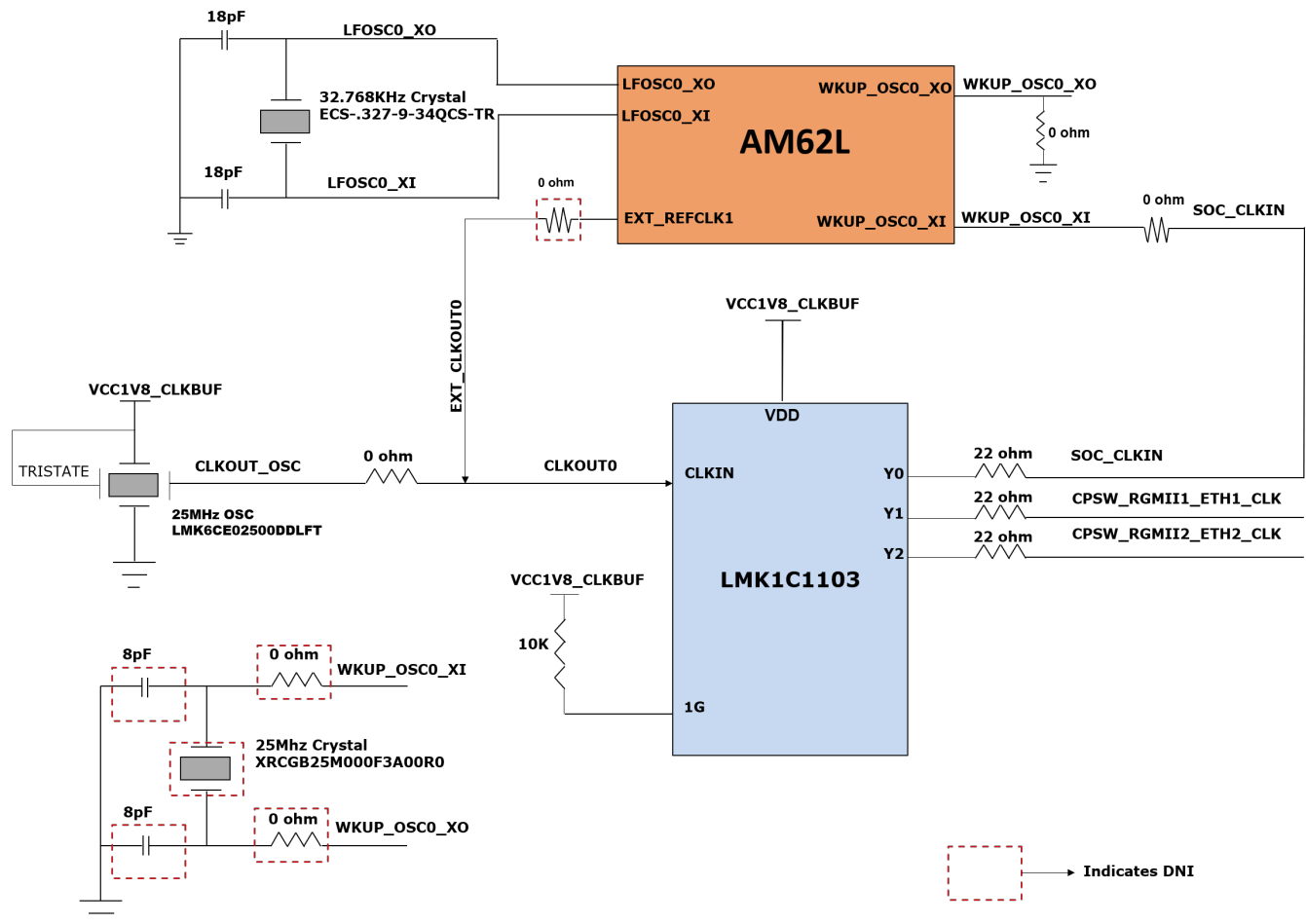


図 2-33. クロック アーキテクチャ

クロック バッファ (型番 LMK1C1103PWR) は、SoC および 2 つのイーサネット PHY に 25MHz のクロックを供給するために使用されます。LMK1C1103PWR は 1:3 の LVCMOS クロック バッファで、25MHz 水晶振動子 / LVCMOS リファレンス入力を取り込み、3 つの 25MHz LVCMOS クロックを出力します。クロック バッファのソースは、SoC からの CLKOUT0 ピンまたは 25MHz 発振器のいずれかであり、抵抗セットを使用して選択します。デフォルトでは、AM62L EVM のクロック バッファへの入力として発振器が使用されます。クロック バッファの出力 Y1 および Y2 は、2 つのギガビットイーサネット PHY のリファレンス クロック入力として使用されます。

AM62L SoC には、RTC ドメインにクロックを供給するために、1 つの外部水晶振動子 (32.768kHz) が取り付けられています。

SOC RTC DOMAIN

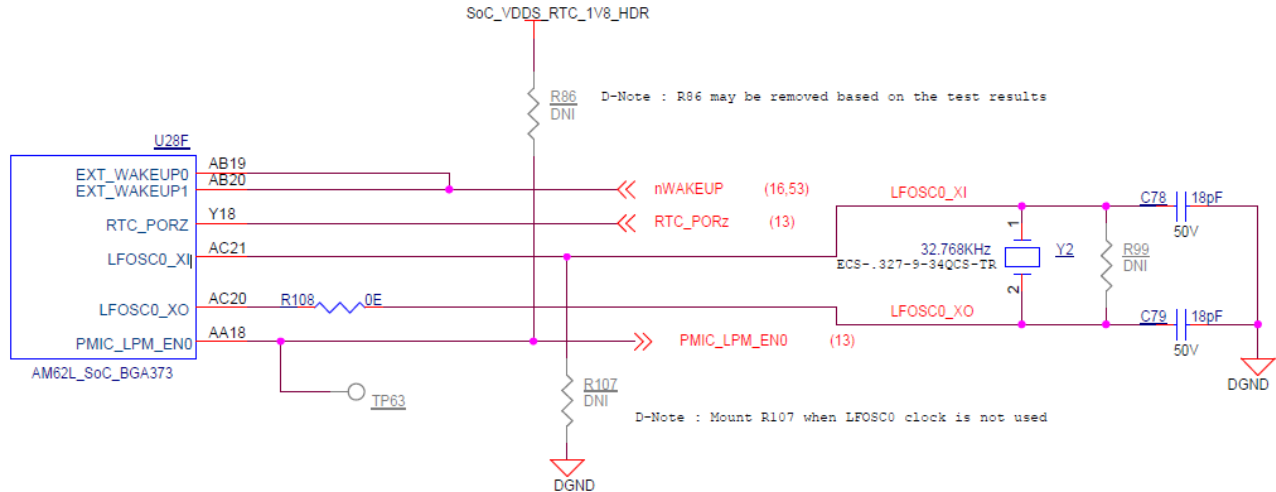


図 2-34. SOC RTC ドメイン クロック

2.8.1 ペリフェラル リファレンス クロック

XDS110、FT4232、M.2 インターフェイス、HDMI フレーマ、オーディオ コーデックなどのペリフェラルに必要なクロック入力、個別の水晶振動子または発振器を使用してローカルで生成されます。EVM ペリフェラルにリファレンス クロックを提供するために使用される水晶振動子または発振器を、表 2-31 に示します。

表 2-31. クロック表

ペリフェラル	メーカー型番	説明	周波数
XDS110 エミュレータ (Y4)	XRCGB16M000FXN01R0	CRY 16.000MHz 8pF SMD	16.000MHz
FT4232 ブリッジ (Y1)	445I23D12M00000	CRY12.000MHz 18pF SMD	12.000MHz
M.2 インターフェイス (U66)	ECS-327MVATX-2-CN-TR	OSC 32.768KHz CMOS SMD	32.768KHz
オーディオ コーデック (U59)	LMK6CE012288CDLFT	OSC12.288MHz CMOS SMD	12.288MHz
HDMI フレーマ (U27)	LMK6CE012288CDLFT	OSC12.288MHz CMOS SMD	12.288MHz

HDMI トランスミッタが必要とするクロックは、オンボード発振器 または SoC の AUDIO_EXT_REFCLK1 のいずれかから供給できます。これらは、抵抗マルチプレクサで選択できます。M.2 モジュールへの 32.768kHz のクロックは、AM62L SoC の WKUP_CLKOUT0 ボールからデフォルトで供給されます。

2.9 リセット

AM62L EVM のリセット アーキテクチャを、図 2-35 に示します。SoC には次のリセット機能があります。

- RESETSTATz は、MAIN ドメインのウォーム リセット ステータス出力です。
- RESETz は、MAIN ドメインのウォーム リセット入力です
- PORz は、MAIN ドメインのパワー オン / コールドリセット入力です
- RTC_PORz は、RTC ドメインのパワー オン / コールドリセット入力です

パワーオンリセット時に、MAIN ドメインに接続されているすべてのペリフェラル デバイスは RESETSTATz によってリセットされます。

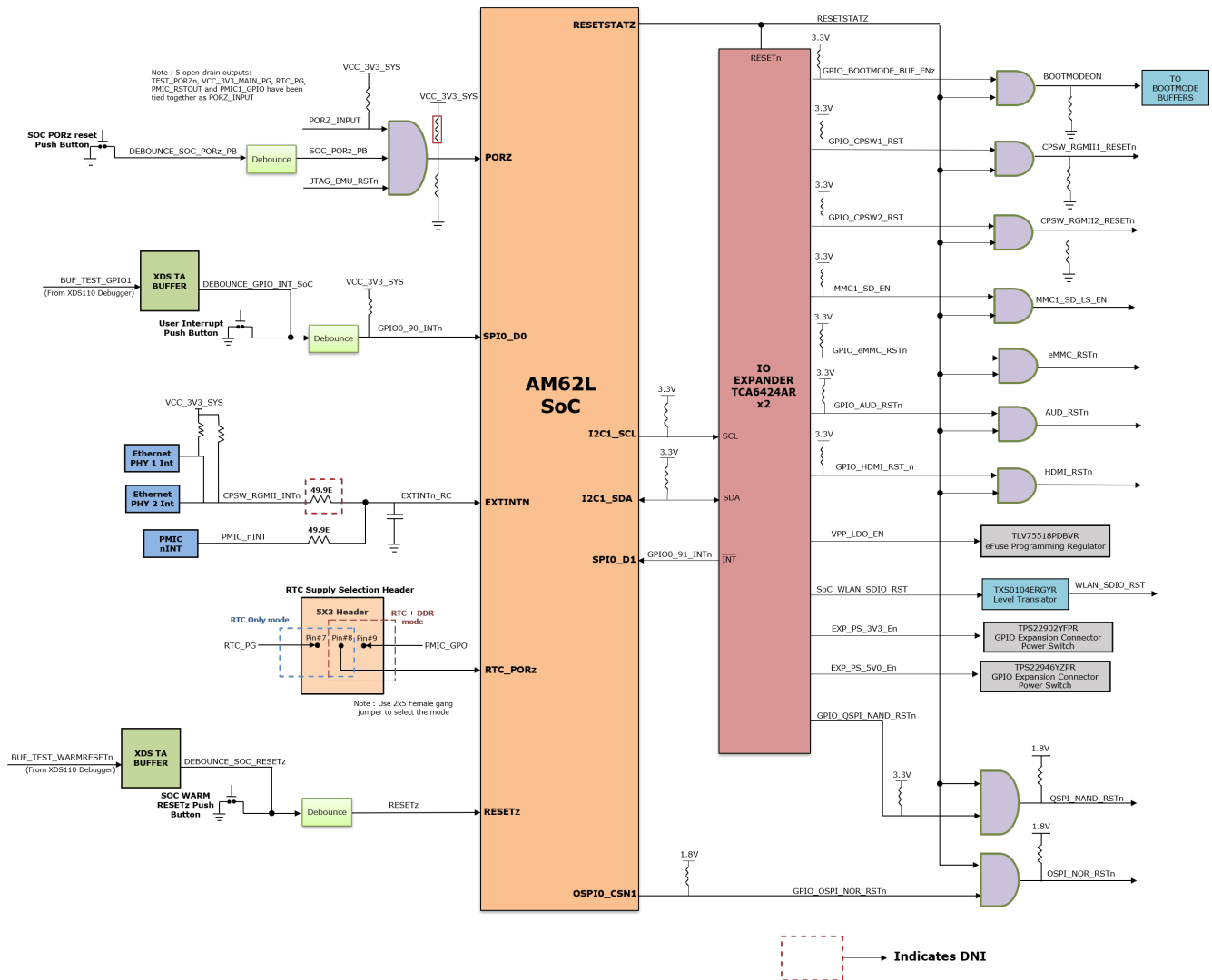


図 2-35. リセットのブロック図

2.10 拡張ヘッダ

AM62L EVM には、2 つの GPIO 拡張ヘッダが搭載されています。

2.10.1 GPIO 拡張ヘッダ

AM62L EVM は、10 ピンおよび 30 ピン GPIO 拡張コネクタ (それぞれ、メーカー型番 67997-410HLF およびメーカー型番 PREC015DAAN-RC) を使用した GPIO 拡張インターフェイスをサポートしています。

10 ピンと 30 ピンの GPIO 拡張コネクタに、以下のインターフェイスおよび I/O が搭載されています。

- 2x SPI:1 CS 付き SPI1 および 1 CS 付き SPI3
- 1x I2C:I2C3
- 1 × UART:UART4
- 13x GPIO:MAIN ドメインからの GPIO
- 5V および 3.3V 電源 (電流制限:155mA と 500mA)

5V および 3.3V の各電源は、それぞれ 155mA および 500mA に電流制限されます。これは、2 個の個別ロードスイッチ TPS22902YFPR および TPS22946YZPR を使用して実現しています。ロードスイッチのイネーブルは、I2C ベースの GPIO ポート エクスパンダと、J26、J25 の各ジャンパを使用して制御できます。J26、J25 の各ジャンパを短絡すると、5V および 3.3V の電源を手動で有効にできます。

2x5 (10 ピン) GPIO 拡張コネクタ (J3) からルーティングされる信号を、表 2-32 に示します。

GPIO 拡張信号は HDMI インターフェイスと共有されます。デフォルトでは、信号は HDMI インターフェイスにルーティングされ、その信号ルーティングはソフトウェアおよび J29 ジャンパの短絡によって、SoC_VOUT0_FET_SEL0、SoC_VOUT0_FET_SEL1 を介して制御できます。

表 2-32. 10 ピン GPIO 拡張コネクタ (J3)

ピン番号	SoC ボール	ネット名
1	-	VCC3V3_EXP
2	-	VCC5V0_EXP
3	-	VCC3V3_EXP
4	-	VCC5V0_EXP
5	-	VCC3V3_EXP
6	-	DGND
7	F22	GPIO0_29_EXP
8	H18	GPIO0_26_EXP
9	H20	GPIO0_24_EXP
10	H19	GPIO0_23_EXP

2x15 (30 ピン) GPIO 拡張コネクタ (J2) からルーティングされる信号を、表 2-33 に示します。

表 2-33. 30 ピン GPIO 拡張コネクタ (J2)

番号	SoC ボール	ネット名
1	M19	GPIO0_34_EXP
2	N19	GPIO0_32_EXP
3	-	DGND
4	N20	GPIO0_33_EXP
5	L21	GPIO0_31_EXP
6	L20	GPIO0_41_EXP
7	M21	GPIO0_40_EXP
8	-	DGND
9	N21	GPIO0_39_EXP
10	F23	GPIO0_30_EXP
11	-	DGND
12	N23	SPI3_D0_EXP
13	H21	GPIO0_25_EXP
14	P22	SPI3_CLK_EXP
15	N22	SPI3_D1_EXP
16	-	DGND
17	-	DGND
18	G22	UART4_TXD_EXP
19	P23	SPI3_CS0_EXP
20	G23	UART4_RXD_EXP
21	J22	UART4_CTSn_EXP
22	-	DGND
23	H23	UART4_RTSn_EXP
24	L22	I2C3_SCL_EXP
25	-	DGND
26	L23	I2C3_SDA_EXP
27	H22	SPI1_CLK_EXP

表 2-33. 30 ピン GPIO 拡張コネクタ (J2) (続き)

番号	SoC ボール	ネット名
28	K22	SPI1_D0_EXP
29	J23	SPI1_D1_EXP
30	K23	SPI1_CS0_EXP

2.11 割り込み

AM62L EVM は、AM62L SoC にリセット入力およびユーザー生成割り込みを提供する 2 つのプッシュ ボタンをサポートしています。これらのプッシュ ボタンは基板上面に配置されており、表 2-34 に示します。

表 2-34. EVM のプッシュ ボタン

シリアル番号	プッシュ ボタン	信号	機能
1	SW7	RESETZ	MAIN ドメイン ウォーム リセット入力
2	SW5	GPIO0_90_INTn	GPIO0_90 (SPI0_D0) に割り込みを生成

2.12 I2C アドレス マッピング

評価基板上の各種ペリフェラルと通信する AM62L I2C インスタンスは 4 つあります。

- SoC_I2C0 インターフェイス: SoC I2C[0] は、基板 ID EEPROM および DSI ディスプレイ コネクタに接続されています。
- SOC I2C1 インターフェイス: SoC I2C[1] は、電流モニタ (x8)、温度センサ (x2)、オーディオ コーデック、HDMI トランスミッタ、GPIO ポート エクスパンダ (x2) に接続されています。
- SOC I2C2 インターフェイス: SoC I2C[2] は、PD コントローラに接続されています。
- WKUP I2C0 インターフェイス: WKUP I2C[0] は PMIC に接続されています。

図 2-36 に I2C ツリーを示し、表 2-35 に AM62L EVM のすべての I2C アドレス マッピングの詳細を示します。

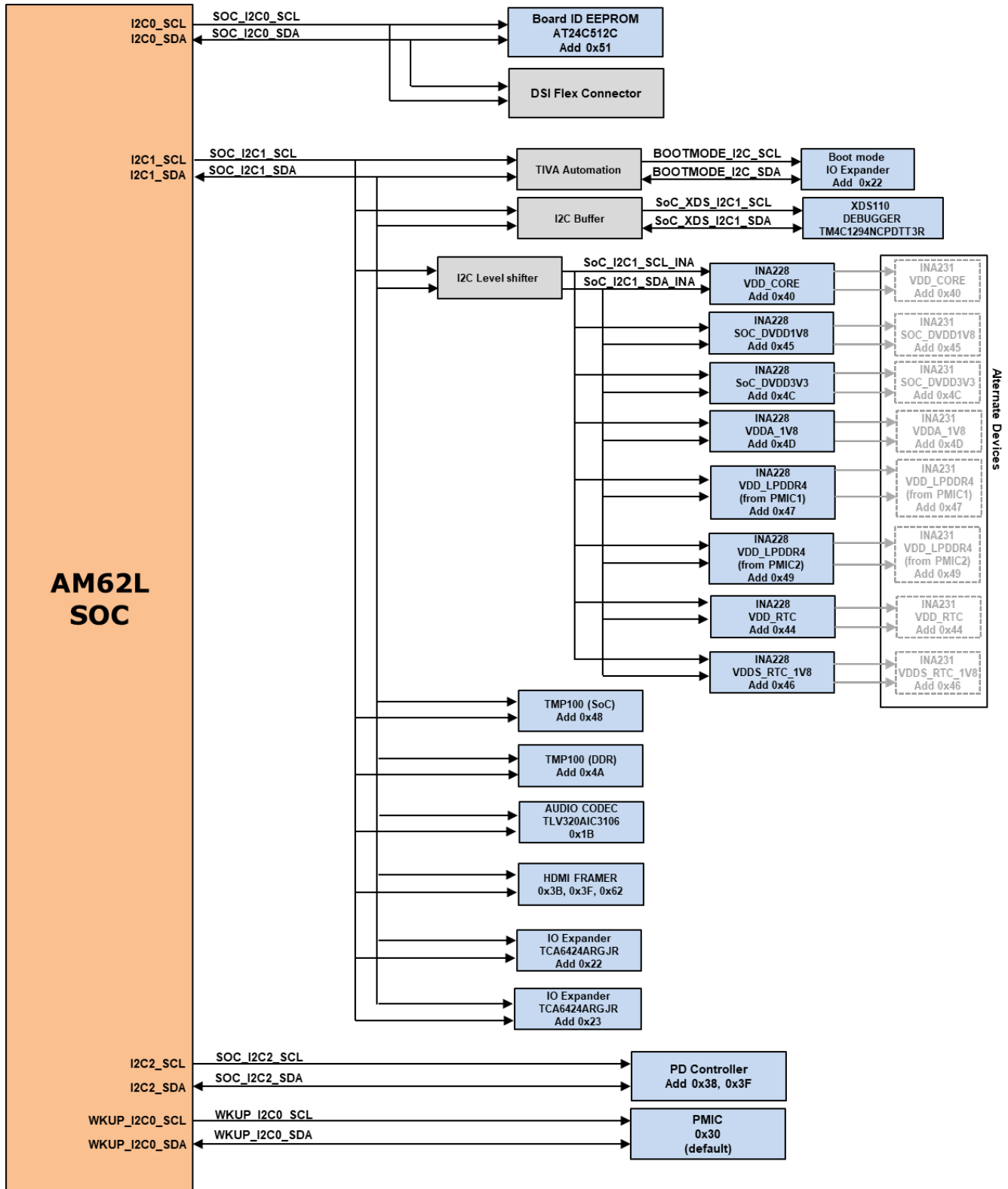


図 2-36. I2C インターフェイス ツリー

表 2-35. I2C マッピング表

I2C ポート	デバイス / 機能	部品番号	I2C アドレス
SoC_I2C0	基板 ID EEPROM	AT24C512C-MAHM-T	0x51
	DSI ディスプレイ コネクタ	<コネクタ インターフェイス>	
SoC_I2C1	GPIO ポート エクスパンダ	TCA6424ARGJR	0x22、0x23
	電流モニタ	INA228AIDGSR	0x40、0x4C、0x45、0x4D、 0x47、0x49、0x44、0x46
	温度センサ	TMP100NA/3K	0x48、0x4A
	オーディオ コーデック	TLV320AIC3106IRGZT	0x1B
	HDMI トランスミッタ	SiI9022ACNU	0x3B、0x3F、0x62
SoC_I2C2	USB PD コントローラ	TPS65988DHRSHR	0x38、0x3F
WKUP_I2C0	PMIC	PTPS6521401VAFR	0x30
その他			
BOOTMODE_I2C	I2C ブートモード バッファ	TCA6424ARGJR	0x22

3 ハードウェア設計ファイル

3.1 回路図

回路図のダウンロードについては、[設計ファイル](#)を参照してください。

3.2 PCB のレイアウト

PCB のガイドラインおよびレイアウト例をダウンロードするには、[設計ファイル](#)のページを参照してください。

3.3 部品表 (BOM)

部品表 (BOM) をダウンロードするには、[設計ファイル](#)のページを参照してください。

4 準拠に関する情報

4.1 準拠および認証

EMC、EMI、ESD への準拠

本製品に取り付けられているコンポーネントは、静電気放電 (ESD) の影響を受けやすくなっています。テキサス・インスツルメンツでは、本製品は ESD が制御された環境において使用されることを推奨しています。これには、ESD の蓄積を抑えるために温度や湿度が制御された環境も含まれます。また、本製品との接続時には、リストストラップや ESD マットなどの ESD 保護具の使用が推奨されます。

本製品は実験室に類似した基本的な電磁環境で使用され、EN IEC 61326-1:2021 に準拠した規格が適用されます。

5 追加情報

5.1 ハードウェアまたはソフトウェアに関する既知の問題

このセクションでは、各 EVM リビジョンにおける現時点での既知の問題と、それに対する適用可能な回避方法について説明します。パッチが適用された問題には、EVM アセンブリに変更ラベルが付けられています。

問題の番号	問題のタイトル	問題の説明	影響を受けるバリエーション
問題 1	5V/0.5A を供給するための外部パワーパス	VCC_5V0 レールで不要なリーク電流が観測されました	E1
問題 2	温度センサ - LPDDR4	I2C バスで U22 および U128 とアドレス競合	E1
問題 3	ブートモード IO エクスパンダ	BUF_TEST_POWERDOWN が Low にアサートされている間、ブートモード IO エクスパンダの電力がオフになります	E1

問題の番号	問題のタイトル	問題の説明	影響を受けるバリエーション
問題 4	RTC モードでの電流モニタ アクセス	RTC 専用モードでは、XDS110 テスト オートメーションが電流モニタにアクセスできません	E1、E1-1

5.1.1 問題 1 - 5V/0.5A を供給するための外部パワー パス

該当する評価基板のリビジョン:E1

問題の説明: USB Type-C DRP ポートが電源に接続されると、VCC_5V0 レールに不要なリーク電流が発生し、電圧が期待するレベルを超えます。

回避方法: この問題を軽減するために、受動部品の値を調整して PMOS のゲート-ソース間電圧 (Vgs) を変更し、VCC_5V0 側のリーク電流を低減できます。

5.1.2 問題 2 - 温度センサ - LPDDR4

該当する評価基板のリビジョン:E1

問題の説明: I2C バス上で、U22 および U128 とのアドレスの競合が発生しています。

回避方法: 10K 値の R124 抵抗を取り付けます。

5.1.3 3 - ブートモード IO エクспанダの問題

該当する評価基板のリビジョン:E1

問題の説明: BUF_TEST_POWERDOWN が Low にアサートされている間、ブートモード IO エクспанダの電力がオフになります。

回避方法: BUF_TEST_POWERDOWN が Low にアサートされている間に VCC_3V3_MAIN がオン状態を維持するよう、VCC_3V3_MAIN イネーブル信号を TEST_POWERDOWN ロジックから削除します。

5.1.4 問題 4 - RTC モードでの電流モニタ アクセス

該当する評価基板のリビジョン:E1、E1-1

問題の説明: 電流モニタの電源端子が不適切なため、XDS110 テスト オートメーションは RTC 専用モード中は電流モニタにアクセスできません。

回避方法: INA228 電流モニタの電源端子を VCC_3V3_MAIN に変更します。

5.2 商標

FreeRTOS™ is a trademark of Amazon Technologies, Inc.

TI™ and Code Composer Studio™ are trademarks of Texas Instruments.

Arm® and Cortex® are registered trademarks of Arm Limited (or its subsidiaries) in the US and/or elsewhere.

Linux® is a registered trademark of Linus Torvalds.

USB 2.0 Type-C® and USB Type-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum, Inc.

SD® is a registered trademark of SD Card Association.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMI トレードドレス、および HDMI ロゴは、HDMI Licensing Administrator Inc. の商標または登録商標です。

6 関連資料

1. テキサス・インスツルメンツ: [TMDS62LEVM の設計ファイル パッケージ](#)
2. テキサス・インスツルメンツ: [AM62L の電源実装](#)

7 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision A (July 2025) to Revision B (October 2025)	Page
• HDMI 商標情報を追加。.....	1
• EVM の PCB 設計リビジョンおよびアセンブリ バリエーション に PROC181E1-1a を追加.....	6

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、TI は一切の責任を拒否します。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](https://www.ti.com) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月